

2024年3月期 第2四半期

(2023年4月1日 ~ 2023年9月30日)

# 決算説明資料

ENOMOTO Co.,Ltd.

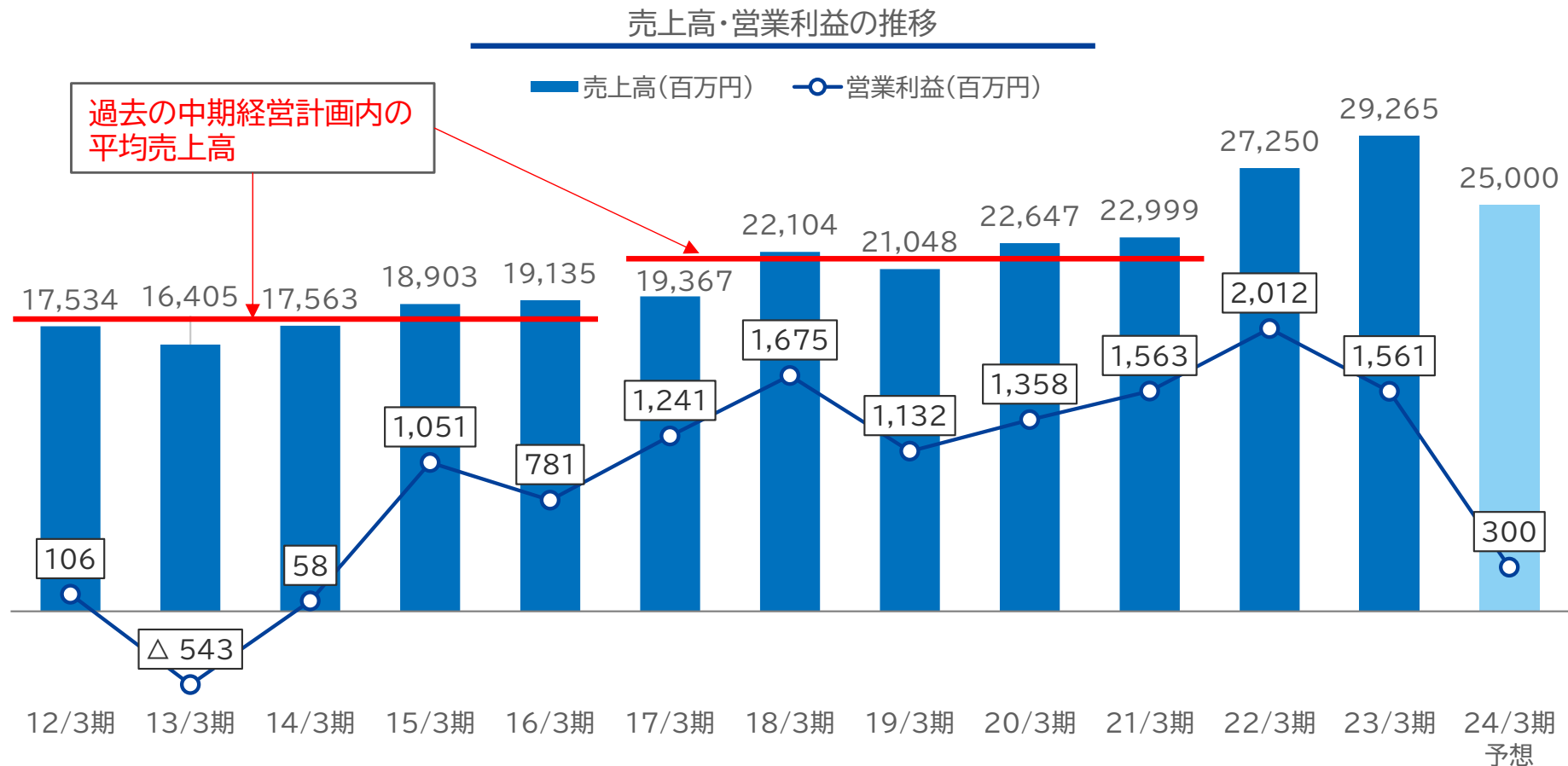
東証プライム 証券コード:6928

(1) 業績概要	P. 3
(2) 市場環境と当社製品	P. 6
(3) 2024年3月期第2四半期決算	P.18
(4) 2024年3月期業績予想	P.25
(5) 中期経営計画の進捗	P.29
(6) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて	P.38
(7) 中期環境計画の進捗(SDGsへの取組み)	P.41
Appendix	P.45

# (1)業績概要



- 2021年3月期までの5年間は、マイクロコネクタ等の成長により売上高200億円前後・営業利益も15億円前後に
- 22年3月期はマイクロコネクタ・パワー半導体用リードフレームがともに好調に推移し売上高272億円、営業利益20億円と過去最高益を計上
- 23年3月期4Qからスマートフォン向けが生産調整、津軽工場新棟など先行投資に伴う償却費の増加もあり24年3月期は大幅減益予想、中期経営計画2ndステップで1stステップの投資の刈り取りを狙う



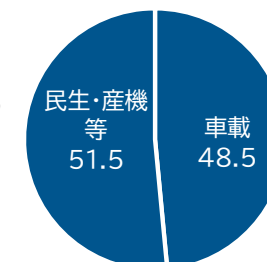
- ・ リードフレームでは車載や産機向けなどにパワー半導体向け製品が伸長
- ・ コネクタ用部品ではマイクロコネクタが伸長、ただし4Qにスマートフォン向けの生産調整により前期並み
- ・ リードフレーム、コネクタ用部品概ね半分とバランスが取れた事業構成

## その他

売上高 659百万円  
 前同比  $\Delta 2.8\%$   
 構成比 2.3%

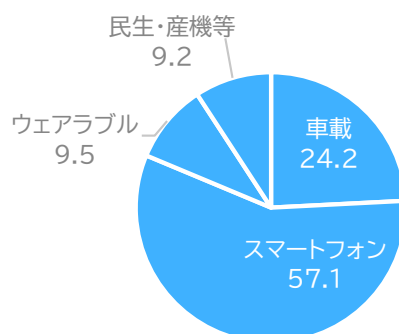
## パワー半導体用リードフレーム

売上高 11,973百万円  
 前同比 20.6%  
 構成比 40.9%



## コネクタ用部品

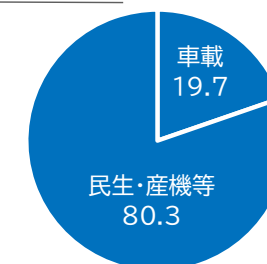
売上高 12,912百万円  
 前同比  $\Delta 0.3\%$   
 構成比 44.1%



売上高  
**29,265**百万円  
 (2023/3期)

## オプト用リードフレーム

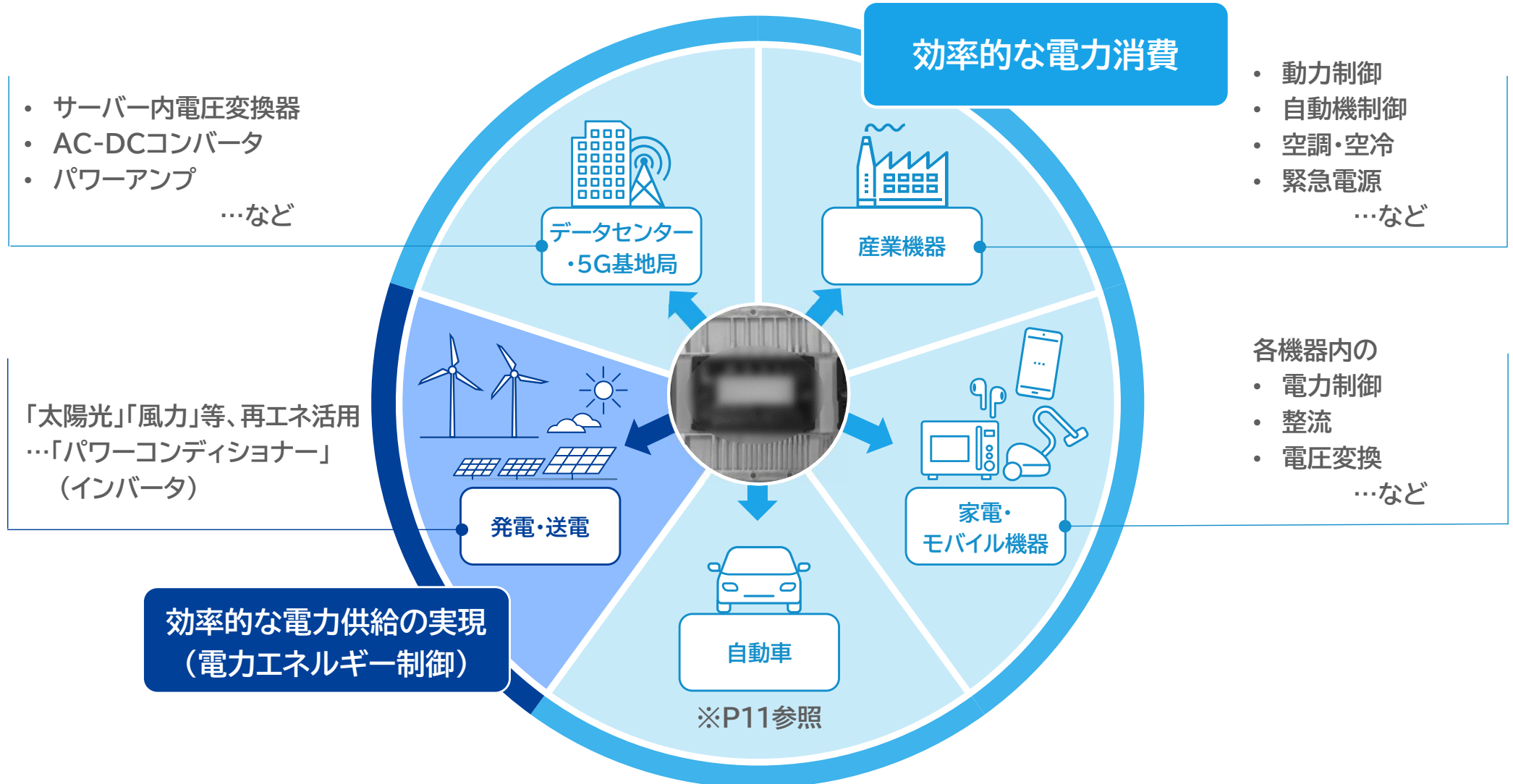
売上高 3,719百万円  
 前同比 0.9%  
 構成比 12.7%



## (2)市場環境と当社製品



- 環境側面からも、新たな発電技術の開発・発展、高効率な電力供給を支える高機能パワー半導体に注目が集まる
- SiC・GaNパワー半導体を使うことで、高電圧・高電流化に加え低損失を実現し、高出力・省エネに寄与

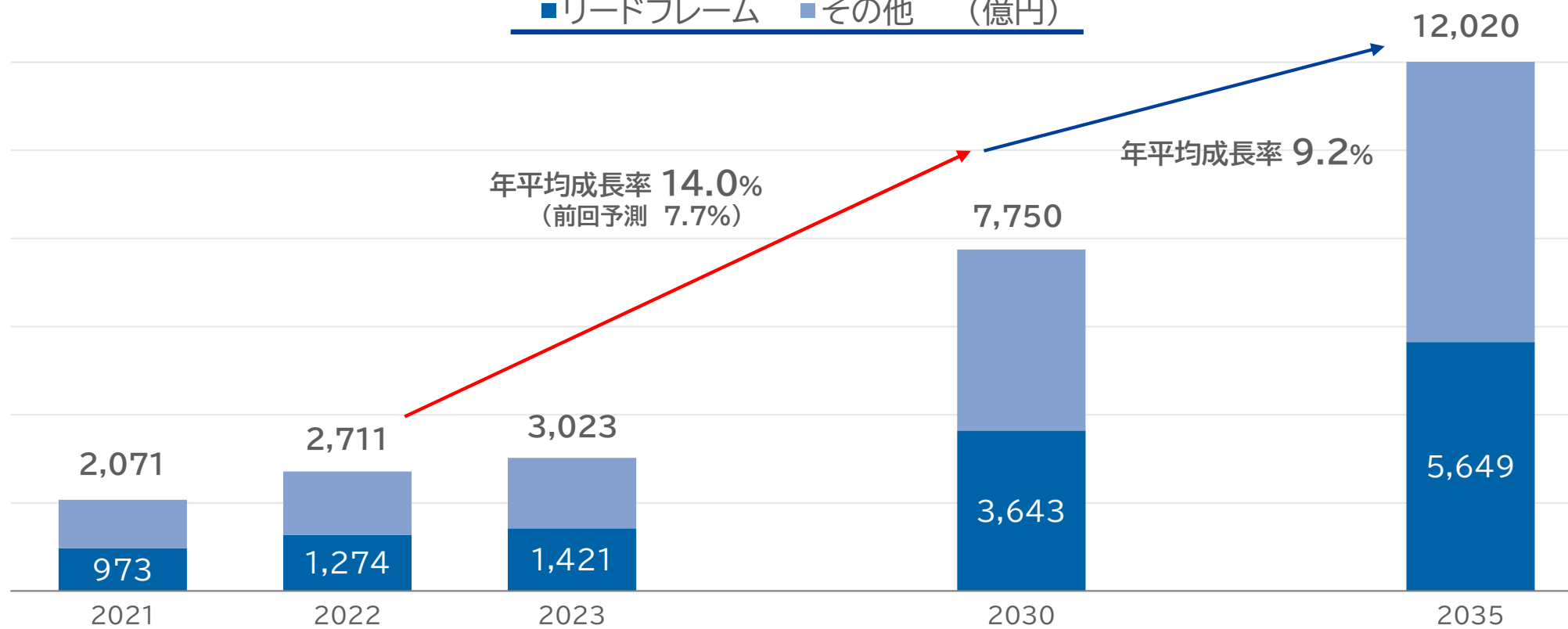


\* SiCはSilicon Carbide(炭化ケイ素)、GaNはGallium Nitride(窒化ガリウム)の略

- リードフレームを含むパワーデバイス構成部材\*は2035年には1兆2,020億円へ2030年までの年平均成長率は14%と、前回予想の7.7%から大幅に上方修正
- 構成部材のうち、約47%がリードフレームと推定

## パワーデバイス構成部材の市場予測

■ リードフレーム ■ その他 (億円)



予測

\* 構成部材の市場はパワー半導体市場の内訳  
出所:富士経済「2023年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」



- 車載ECU\*1やデータセンター向けパワー半導体の高電圧・高電流化に伴い、従来のリードフレームを上回る高信頼性と省スペース化の要求から接触面積が大きく、通電容量の高いクリップボンディングの注目が高まる
- 需要は拡大しており2023年3月期に前倒しで生産能力を増強。平坦度などの品質要求が高く付加価値率も高い

車載・産業用パワー半導体

小型化

高電流化

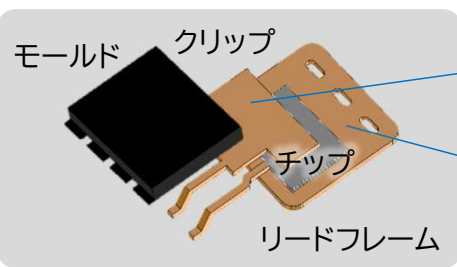
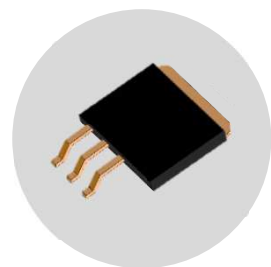
モジュール化



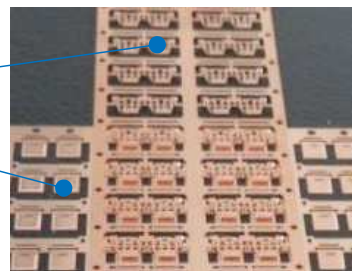
従来品を上回る高信頼性と省スペース性

## クリップボンディングリードフレーム

完成品



当社製品



高耐熱性

長寿命化

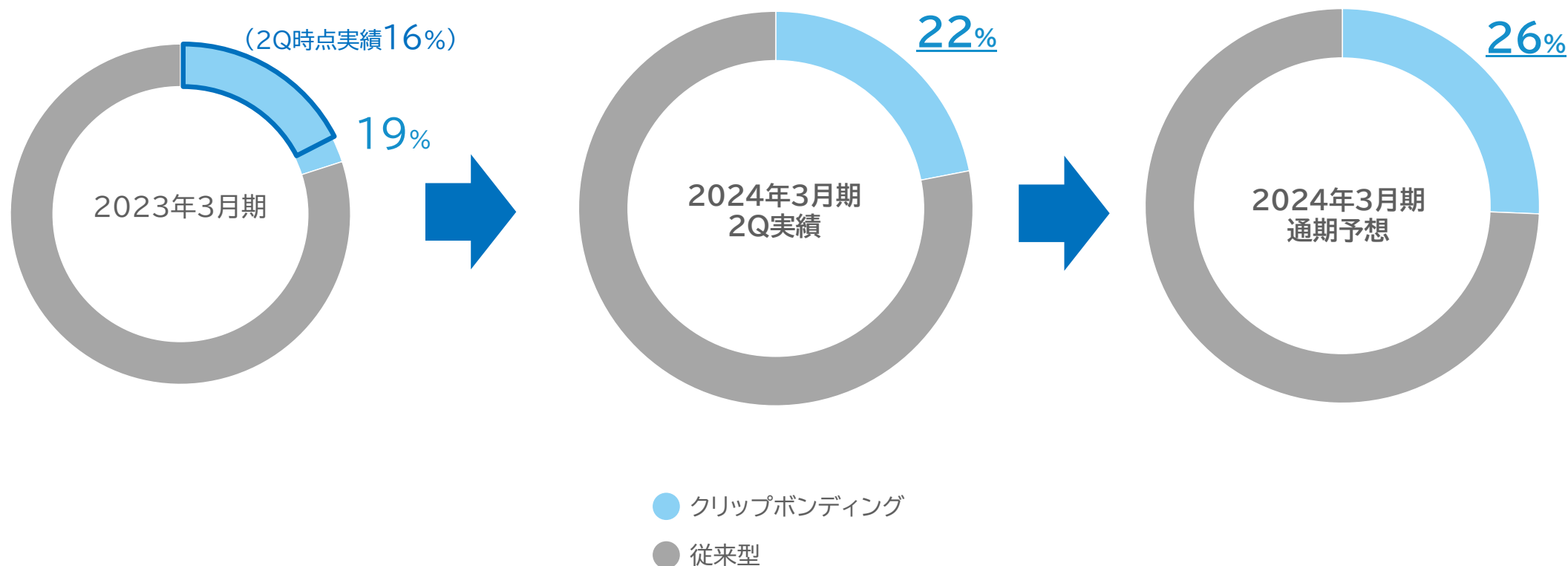
- クリップとリードフレームでチップを挟み込むため大きな面で接続でき、電気特性と熱特性が高まる
- 平坦度(位置精度)が低いと非接触部分ができパワー半導体の電流量が低下

平坦度(位置精度)・清浄度の要求が高く、高い付加価値率  
他社に先駆けて本格量産開始

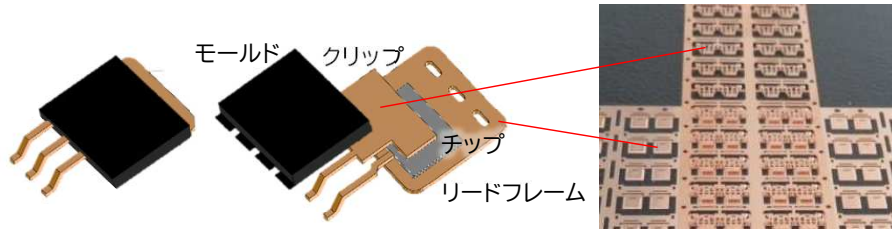
\*1 ECU Electronic Control Unit

- 当社のパワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの売上構成は2023年3月期の19%から2024年3月期2Q時点で22%まで成長
- 先行している中国に加えて、日本・フィリピンでの生産拡大を見込む2024年3月期は26%まで上昇する見通し
- 当社はクリップボンディングリードフレームの量産で先行、従来型リードフレームに比べて付加価値も高いクリップボンディングの市場拡大により、リードフレーム事業の売上拡大と利益率向上を目指す

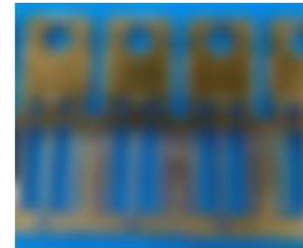
パワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの構成比



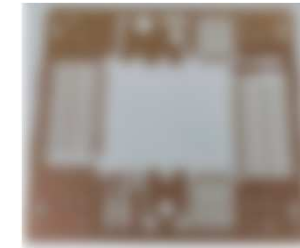
## クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム



汎用パワー半導体用  
リードフレーム



IGBT用  
リードフレーム



パワーIC用  
リードフレーム



- 上記部品が後工程を経てパワーデバイスモジュールを構成し、車載(制御系など)に使用される
- EV等の新エネルギー車向けで、クリップボンディング方式が適するSiCパワーデバイスの需要拡大
- 主に中国のEV向けに需要拡大

## パワーデバイス適用製品 計40品種以上

### パワートレイン制御

- モーター制御
- バッテリー
- インバータ
- レギュレータ
- オルタネータ
- トランスミッション制御
- ラジエーターファン制御



### 車両制御

- ステアリング制御
- クルーズ制御

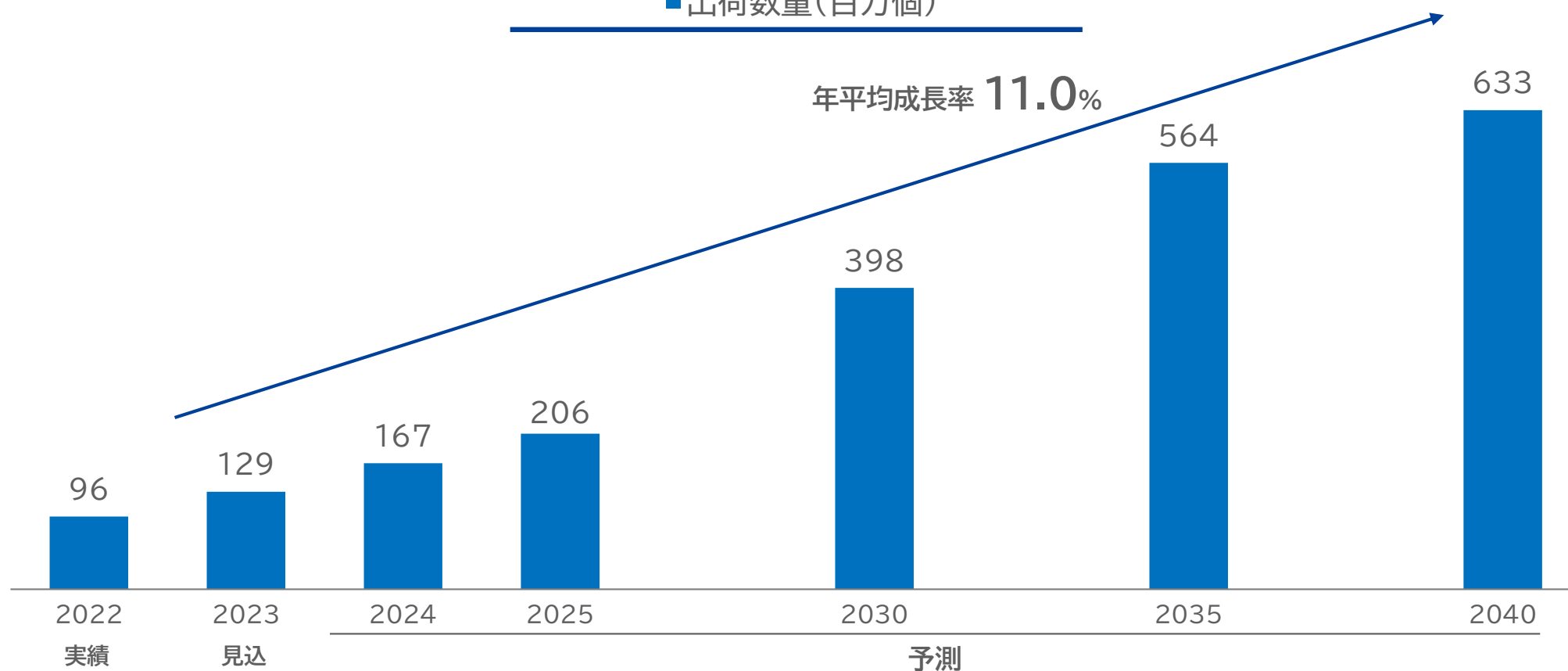
### ボディ制御

- パワーウィンドウ
- オートマチックドアロック
- 電動シート
- ライト制御
- ナビコン
- マイコンエアコン

- 車載向けパワーデバイスモジュールの出荷数量は2040年までに年平均11.0%成長を予測
- 日本ではHV向け、欧州、北米、中国はPHV\*やEV向けの製品が拡大

## 車載向けパワーデバイスモジュールの出荷数量

■ 出荷数量(百万個)

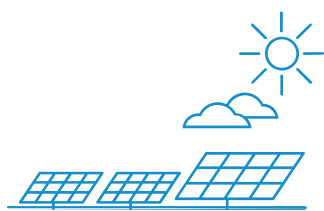


\* PHVはPlug in Hybrid Vehicle の略  
出所:富士キメラ総研「2023 次世代カーテクノロジーの本命予測」

- 温室効果ガス排出実質ゼロの実現にはあらゆる分野・製品のエネルギー効率向上が必要
- 世界の電力の50~60%はモータで消費すると言われ、インバータによる効率的な電力の変換や制御のため高機能パワー半導体がキーデバイスとなる

## 「温室効果ガス排出実質ゼロ」の実現へ 「GX」とは ... 「パワービジネス」

あらゆる分野・製品のエネルギー効率向上



発電



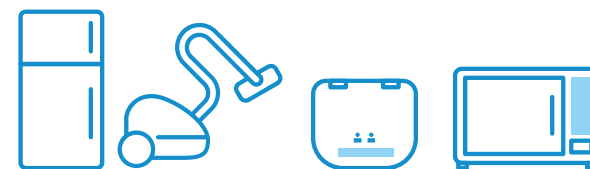
自動車(EV)



空調



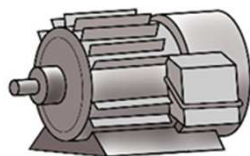
ロボット



家電/デジタル家電

### 省エネの実現

インバータ、コンバータ、レギュレータetc...



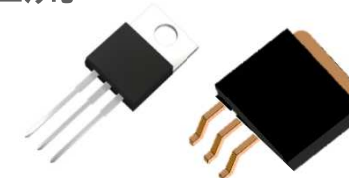
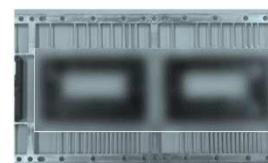
モータ

### パワー半導体

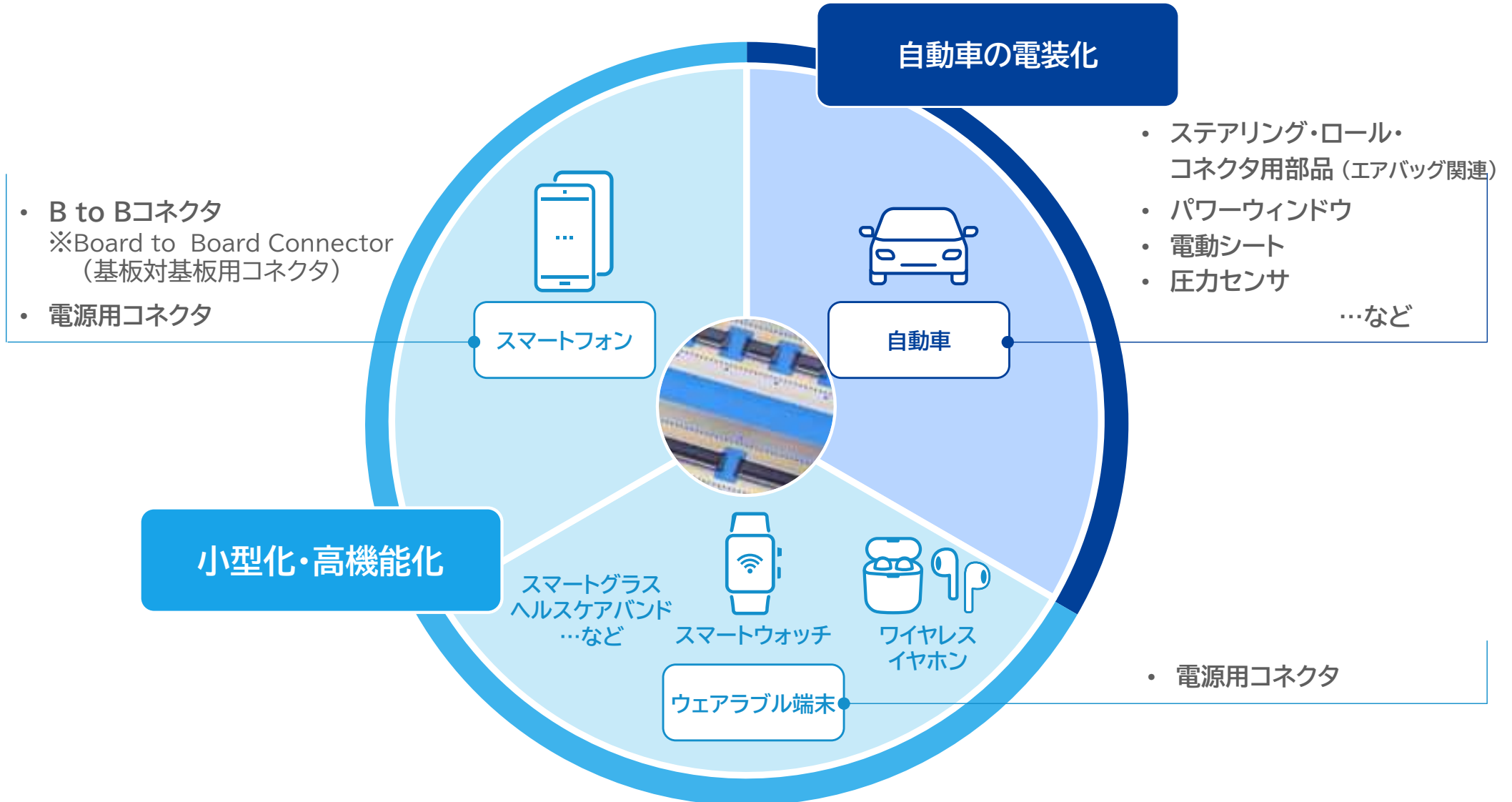
整流

電圧変換

交流⇔直流



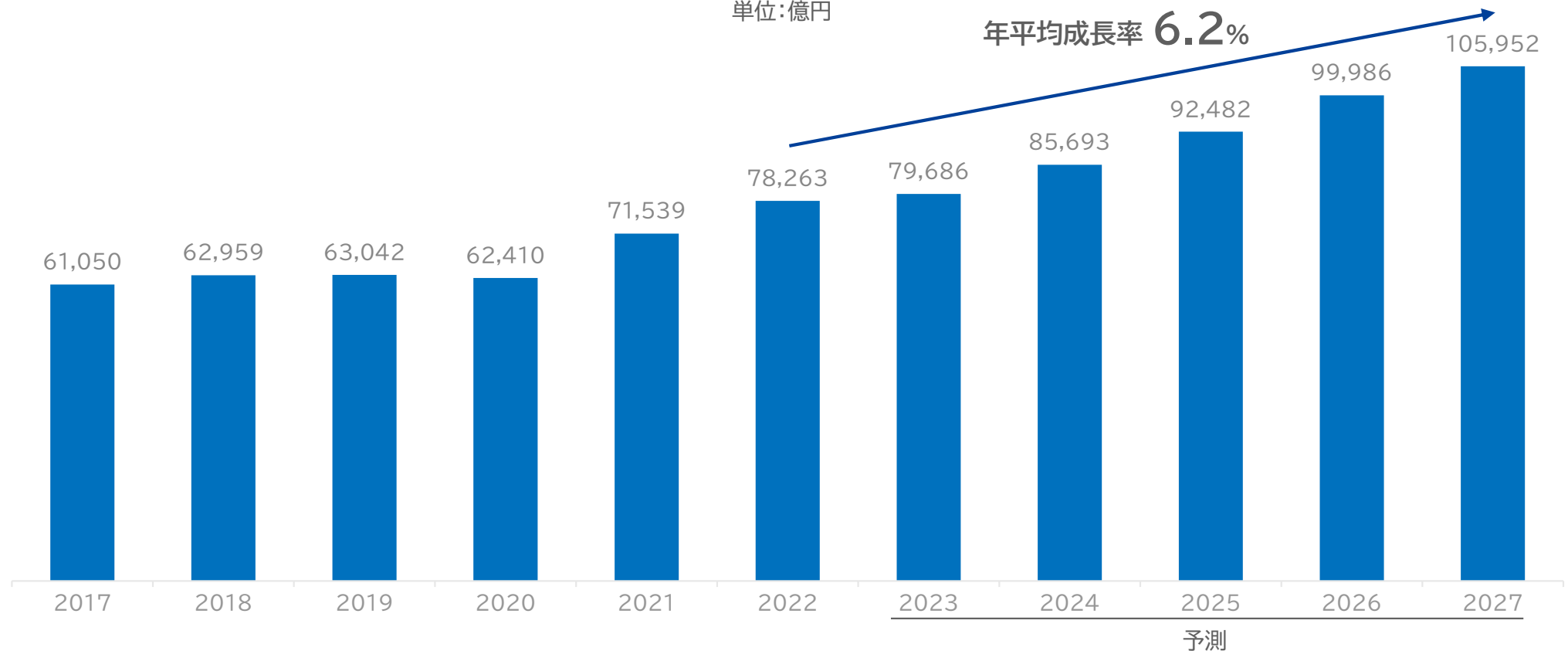
- スマートフォン・ウェアラブル端末向けの極小部品から、自動車向けの特殊で大きな部品まで幅広く対応
- 超微細で高品質な部品を安定して大量生産



- コネクタ市場は年平均6.2%の成長が続くと予想
- 2023年以降はスマートフォン、ウェアラブル端末向けが一時的な調整を終え、堅調に増加することに加えて車載向けでEVシフトや自動運転技術の開発による部品の搭載率上昇  
増大するデジタルデータ対応によるデータセンタ向けなどが市場を牽引

コネクタ世界市場規模の推移と需要予測

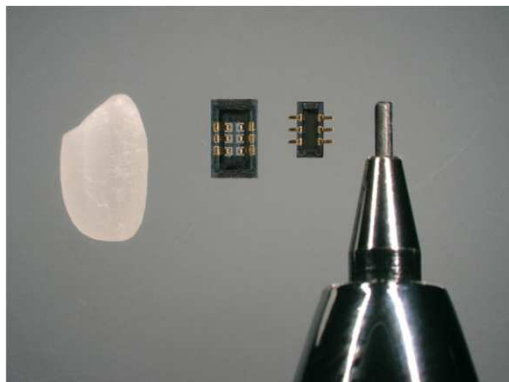
単位:億円



出所:産業情報調査会「2023年版 コネクタ市場」

1

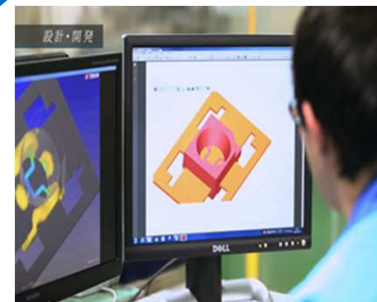
金属と樹脂の複合加工技術力



技術力

2

高品質・大量生産体制を支える  
生産技術力



3

海外でも日本品質の生産体制

中国

クリップボンディング  
リードフレームで先行



フィリピン

車載向けコネクタ用部品の  
主力工場



一貫生産

4

独立系としてのサービスポジション

材料メーカーや  
協力会社

幅広い顧客  
ニーズ

最適な調達



エノモト

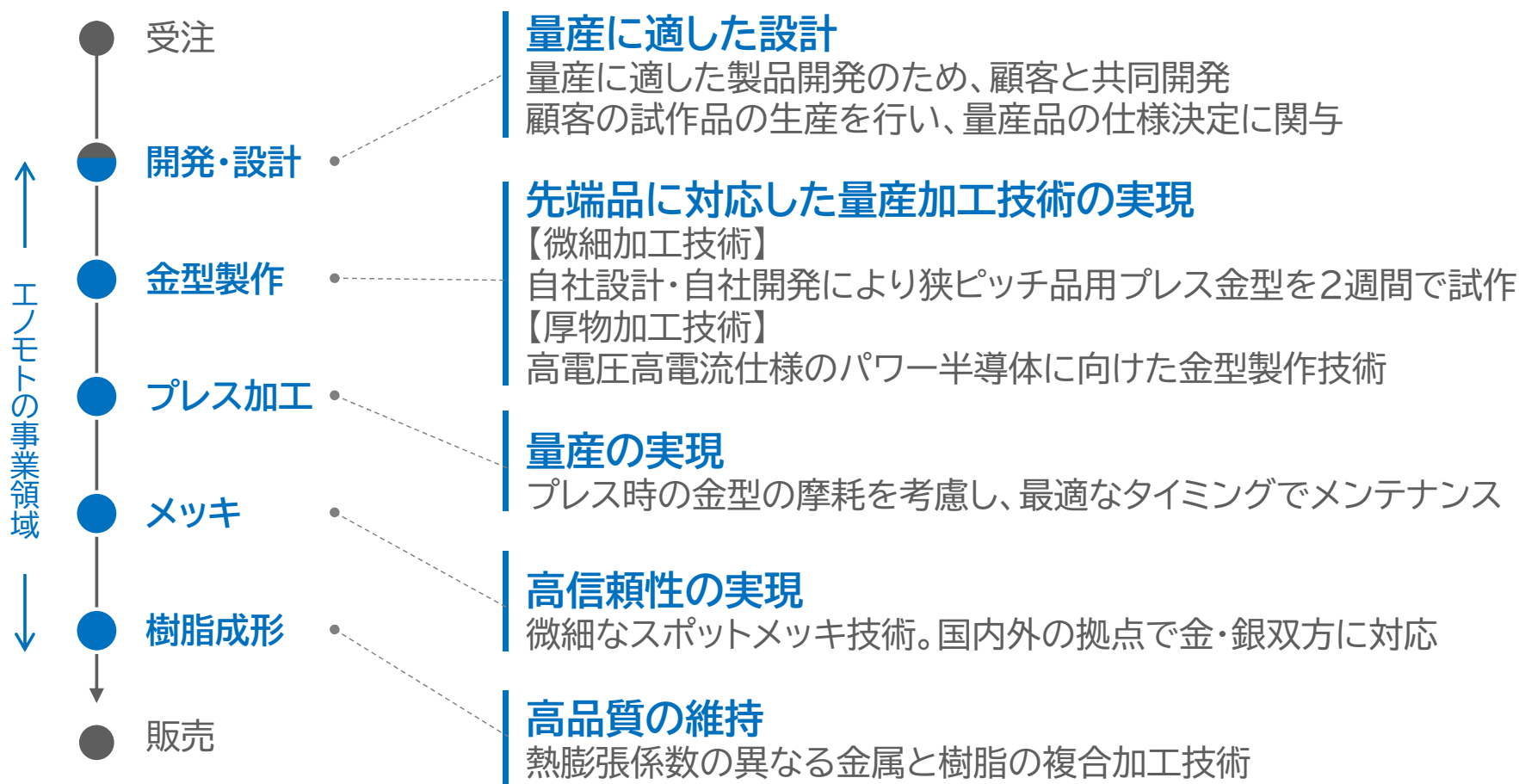


柔軟な対応

特定の資本に縛られない  
自由な営業方針



- ・ 強みである金型の設計・開発、プレス加工の技術を活かし、生産に特化
- ・ スマートフォン向けなどのマイクロコネクタ、パワー半導体用リードフレームの精密加工に強み
- ・ クリップボンディングリードフレーム、マイクロコネクタを大量生産できる企業は限られ、当社への受注が増加



# (3)2024年3月期第2四半期決算



- ・ 円安が増収要因となったものの、中国経済の停滞及び欧米のインフレによる世界的な個人消費の低迷から民生用機器を中心に在庫調整が継続し減収
- ・ 生産能力増強に伴う減価償却費や人財の採用などの先行投資により、営業利益は大幅減益

単位:百万円	2023/3期 2Q累計		2024/3期 2Q累計		期比較	
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前同比(%)	前同比増減
売上高	14,650	100.0	13,020	100.0	△11.1	△1,629
売上総利益	2,173	14.8	1,364	10.5	△37.2	△808
販管費	1,234	8.4	1,227	9.4	△0.6	△6
営業利益	938	6.4	137	1.1	△85.4	△801
為替差損益	138	-	29	-	-	△109
経常利益	1,127	7.7	190	1.5	△83.1	△937
四半期純利益	778	5.3	87	0.7	△88.8	△690
1株当たり 四半期純利益	116.58円	-	13.10円	-		

- 需要は前期4Q比で底打ちしたものの全体的な回復は後倒しとなり、ほぼ横ばいで推移
- 工場稼働率の低下と先行投資に伴う固定費率上昇により、利益は大幅な減益

単位:百万円	2023/3期					2024/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比	1Q比
売上高	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	<b>6,593</b>	△11.0	+2.6
売上総利益	1,155	1,017	1,231	695	4,100	722	<b>642</b>	△36.8	△11.1
販管費	619	615	655	648	2,538	590	<b>637</b>	+3.6	+8.1
営業利益	536	401	575	46	1,561	132	<b>4</b>	△98.8	△96.5
為替差損益	84	53	△80	△20	37	12	<b>16</b>	-	-
経常利益	638	489	516	161	1,805	162	<b>27</b>	△94.4	△83.0
四半期純利益	431	346	433	57	1,269	96	<b>△9</b>	-	-

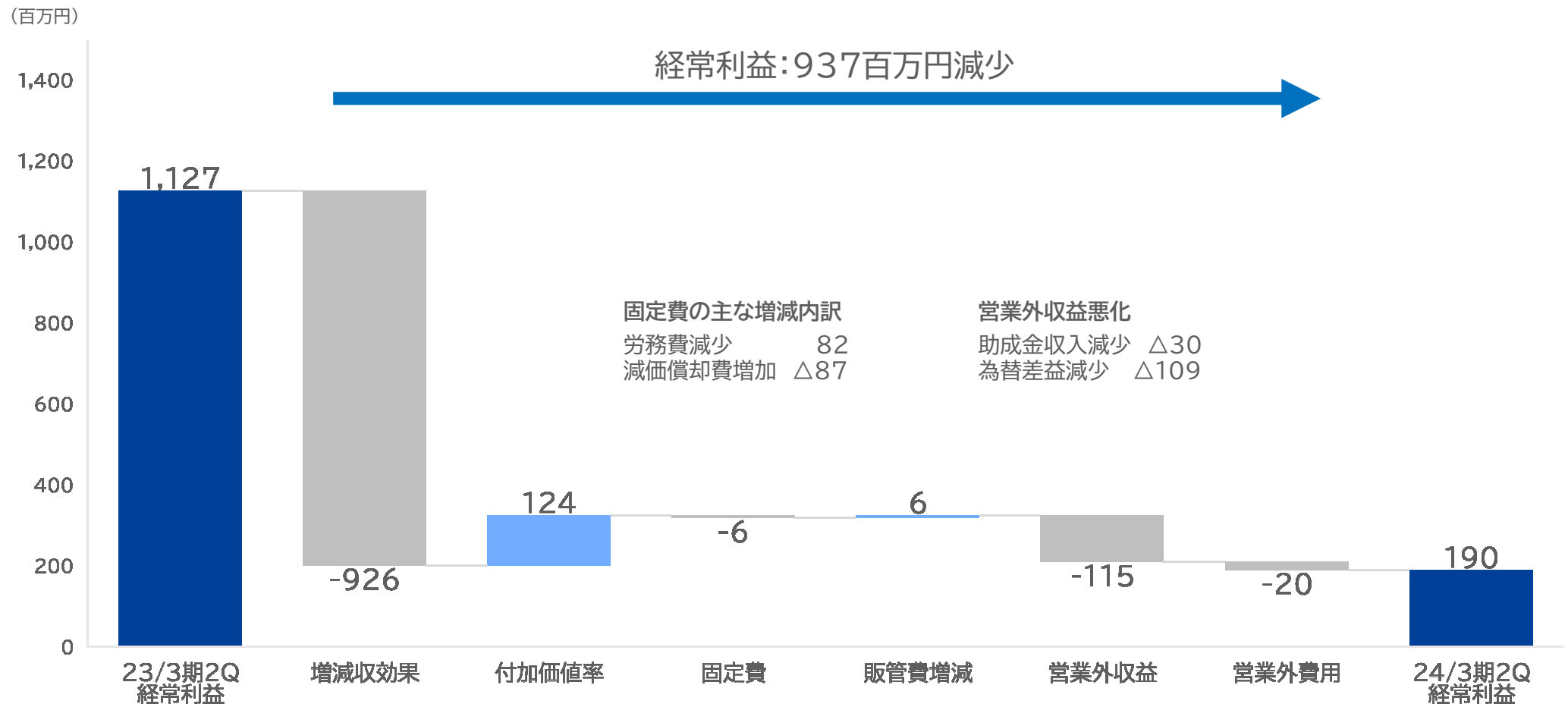
- ・ パワー半導体用リードフレームは、車載向けが堅調に推移したが、民生・産機向けは在庫調整局面
- ・ オプト用リードフレームは、大型ディスプレイ向けが低迷し大幅減収
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向け、ウェアラブル向け共に在庫調整局面だが、1Q比では新機種向けで増加し車載(エアバッグ等)向けは回復基調に

単位:百万円	2023/3期					2024/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同 四半期比	1Q比
パワー半導体用 リードフレーム	2,684	2,797	3,377	3,113	11,973	3,164	<b>2,832</b>	+1.2%	△10.5%
オプト用 リードフレーム	1,008	931	854	925	3,719	712	<b>662</b>	△28.9%	△7.0%
コネクタ用部品	3,408	3,496	3,627	2,379	12,912	2,437	<b>2,970</b>	△15.1%	+21.8%
その他	143	180	180	155	659	112	<b>129</b>	△28.2%	+15.6%
合計	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	<b>6,593</b>	△11.0%	+2.6%

- 増減収効果
- 付加価値率
- 固定費

パワー半導体用リードフレームは増加、一方コネクタ部品とオプト用リードフレームの販売が大幅減少  
クリップボンディングリードフレームの増加により製品ミックスは改善

- ① 生産能力増強に伴う減価償却費増加
- ② 人件費は稼働率低下により、電力費は再エネ利用増と稼働率低下により減少



- ・ 車載はパワー半導体用リードフレームが好調、エアバッグ向けコネクタ等も回復基調
- ・ スマートフォンは前期4Qからの調整が続き、ウェアラブルも在庫調整
- ・ 民生・産機・その他はデータセンター向け等のパワー半導体用が調整、大型ディスプレイ向けのLEDも低迷

## 民生・産機・その他

- ・ 構成比は前期の34.2%から 3.5pt減少  
前年同期比24.2%減少
- ・ データセンター向け、産機向けの  
パワー半導体用リードフレームが在庫調整
- ・ 大型ディスプレイ向けの  
LED用リードフレームが減少

## ウェアラブル

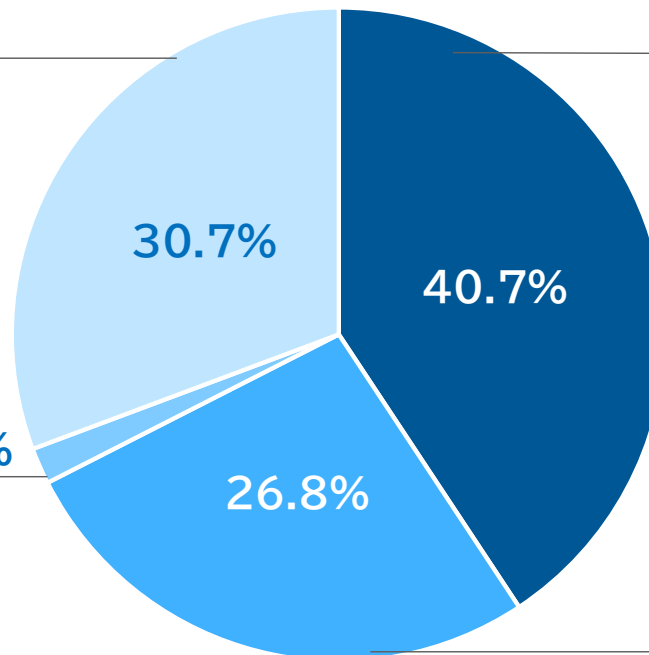
- ・ 構成比は前期の5.3%から 3.5pt減少  
前年同期比71.0%減少
- ・ ワイヤレスイヤホンやウォッチ向けの在庫調整

## 車載

- ・ 構成比は前年同期の32.8%から 7.9pt増加  
前年同期比5.1%増加
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレームが好調
- ・ エアバッグ向けコネクタ等が回復

## スマートフォン

- ・ 構成比は前期の27.7%から 0.9pt減少  
前年同期比17.9%減少
- ・ スマートフォン向けコネクタ部品の減少



- ・ 減収により売上債権や仕入債務が減少
- ・ 1,044百万円のネットキャッシュ、自己資本比率は64.7%と健全

単位:百万円	2023/3期末	2024/3期2Q末	前期末比増減
流動資産	19,051	17,800	△1,250
（内、現預金）	4,041	4,176	+135
（内、受取手形及び 売掛金及び契約資産）	8,617	7,295	△1,321
（内、たな卸資産）	5,720	5,365	△355
固定資産	14,988	15,058	+70
（内、有形固定資産）	13,501	13,521	+20
総資産	34,039	32,859	△1,179
負債	13,444	11,600	△1,843
（内、支払手形及び買掛金）	6,933	5,141	△1,792
（内、有利子負債）	3,132	3,132	+0
純資産	20,594	21,258	+663
負債純資産	34,039	32,859	△1,179



## (4)2024年3月期業績予想



- 下期回復を予想していたが、回復が来期に後倒しの見通しとなり売上高・利益とも下方修正
- 車載向けパワー半導体リードフレームは堅調だが、その他の製品群では調整が続く
- 工場稼働率低下に加えて、津軽工場などの先行投資負担もあり、営業利益率は大幅に低下  
下期はクリップボンディングリードフレームやウェアラブル向けコネクタの構成比上昇で上期比で利益率やや改善  
新製品量産に向けての金型受注は好調なことから、調整明けには収益は回復に向かうと予想

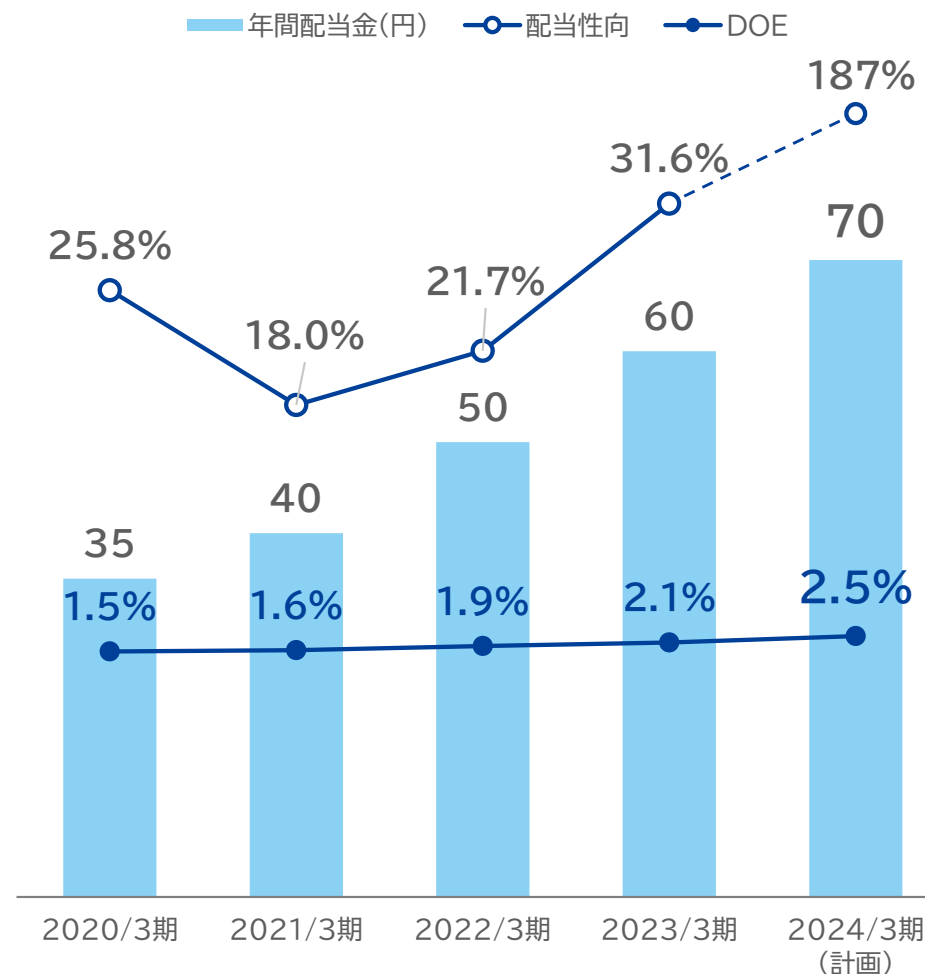
単位:百万円	2023/3期実績		2024/3期				期比較	
	実績	売上比(%)	期初予想	売上比(%)	修正予想	売上比(%)	前期比(%)	修正比
売上高	29,265	100.0	29,000	100.0	<b>25,000</b>	<b>100.0</b>	△14.6	△13.8
売上総利益	4,100	14.0	4,300	14.8	<b>2,850</b>	<b>11.4</b>	△30.5	△33.7
販管費	2,538	8.7	2,600	9.0	<b>2,550</b>	<b>10.2</b>	+0.4	△1.9
営業利益	1,561	5.3	1,700	5.9	<b>300</b>	<b>1.2</b>	△80.8	△82.4
経常利益	1,805	6.2	1,700	5.9	<b>350</b>	<b>1.4</b>	△80.6	△79.4
当期純利益	1,269	4.3	1,250	4.3	<b>250</b>	<b>1.0</b>	△80.3	△80.0
1株当たり当期純利益	190.0円	-	187.1円	-	<b>37.4円</b>	-	-	-
配当金	60.0円	-	70.0円	-	<b>70.0円</b>	-	-	-

- ・ パワー半導体用リードフレームは車載向けが回復基調、民生・産業機器向けの在庫調整終了は4Q後半になる見通し
- ・ オプト用リードフレームは大型ディスプレイなどの低迷が下期も続く見通し
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン、ウェアラブル端末向けの調整が後倒し、車載向けは回復基調

単位:百万円	2023/3期		2024/3期					
	実績	構成比(%)	期初予想	構成比(%)	修正予想	構成比(%)	前期比(%)	修正比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	12,500	43.1	<b>11,500</b>	<b>46.0</b>	△4.0	△8.0
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	3,800	13.1	<b>2,500</b>	<b>10.0</b>	△32.8	△34.2
コネクタ用部品	12,912	44.1	12,000	41.4	<b>10,500</b>	<b>42.0</b>	△18.7	△12.5
その他	659	2.3	700	2.4	<b>500</b>	<b>2.0</b>	△24.1	△28.6
合計	29,265	100.0	29,000	100.0	<b>25,000</b>	<b>100.0</b>	△14.6	△13.8

- 2023年5月に配当方針をDOEをベースに変更、期初予想の70円配当を継続

- 配当金・配当性向の推移



## 2024年3月期以降の配当方針

- DOE\*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 次期中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2024年3月期は70円配当を予想 (DOE2.5%)

\* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

## (5) 中期経営計画の進捗





社是

心技一体

経営理念

経営の中心は人であり、  
健全なものづくりを通じて、  
豊かな社会の実現に貢献する。

## ビジョン2030

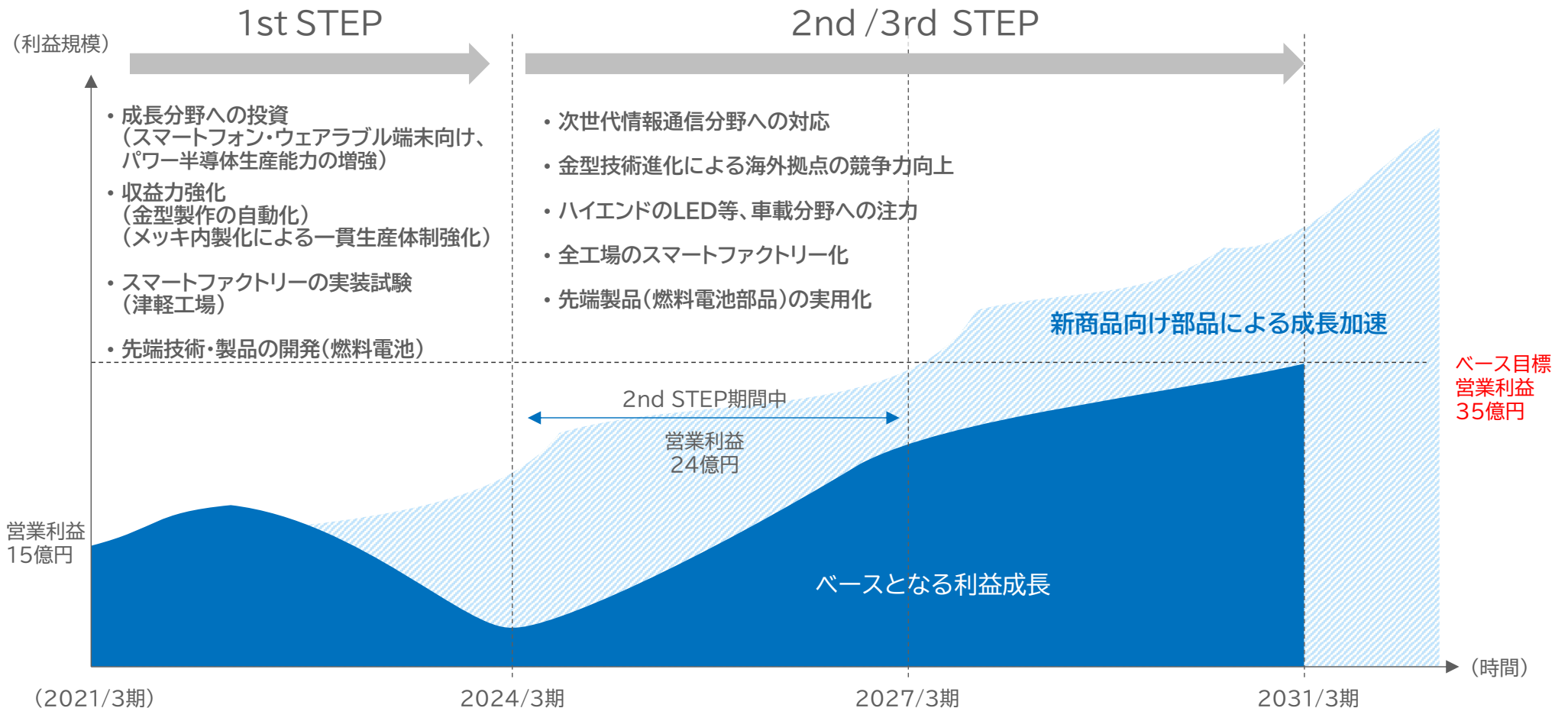
「金型の技術で未来を創る」

より小さく より速く 最先端の技術で  
暮らしとビジネスのベストパートナーを目指す

## ありたい姿

- 金型技術の進化で、最先端の市場に高品質な部品をスピーディに提供し続ける
- 失敗を恐れずチャレンジする職場環境づくりを通じてイノベーションを生み出す
- 燃料電池部品の実用化で脱炭素社会の実現に貢献する

- ビジョン2030では、既存製品の需要拡大を見据えつつ、付加価値率の向上を軸とした各種施策で主力製品のマーケットの成長を上回る利益成長を図る
- 2nd STEPで計画していたパワー半導体生産能力の増強を1st STEPに前倒して実施
- 津軽工場と中国新工場でメッキ工程の内製化(一貫生産体制強化)を行い付加価値を取込み 23年1-3月から稼働開始

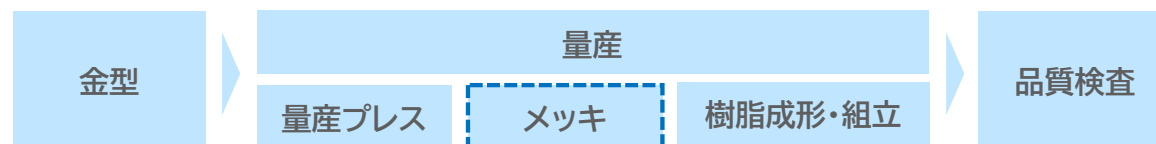


- 一貫生産体制強化のため、メッキ加工の内製化を進め、コネクタやリードフレームで付加価値向上を図る

津軽工場の新ライン



## 当社製品の主な製造工程



メッキの内製化でリードフレームとコネクタ製造の  
全工程をほぼ内製化  
さらなる付加価値の強化を目指す

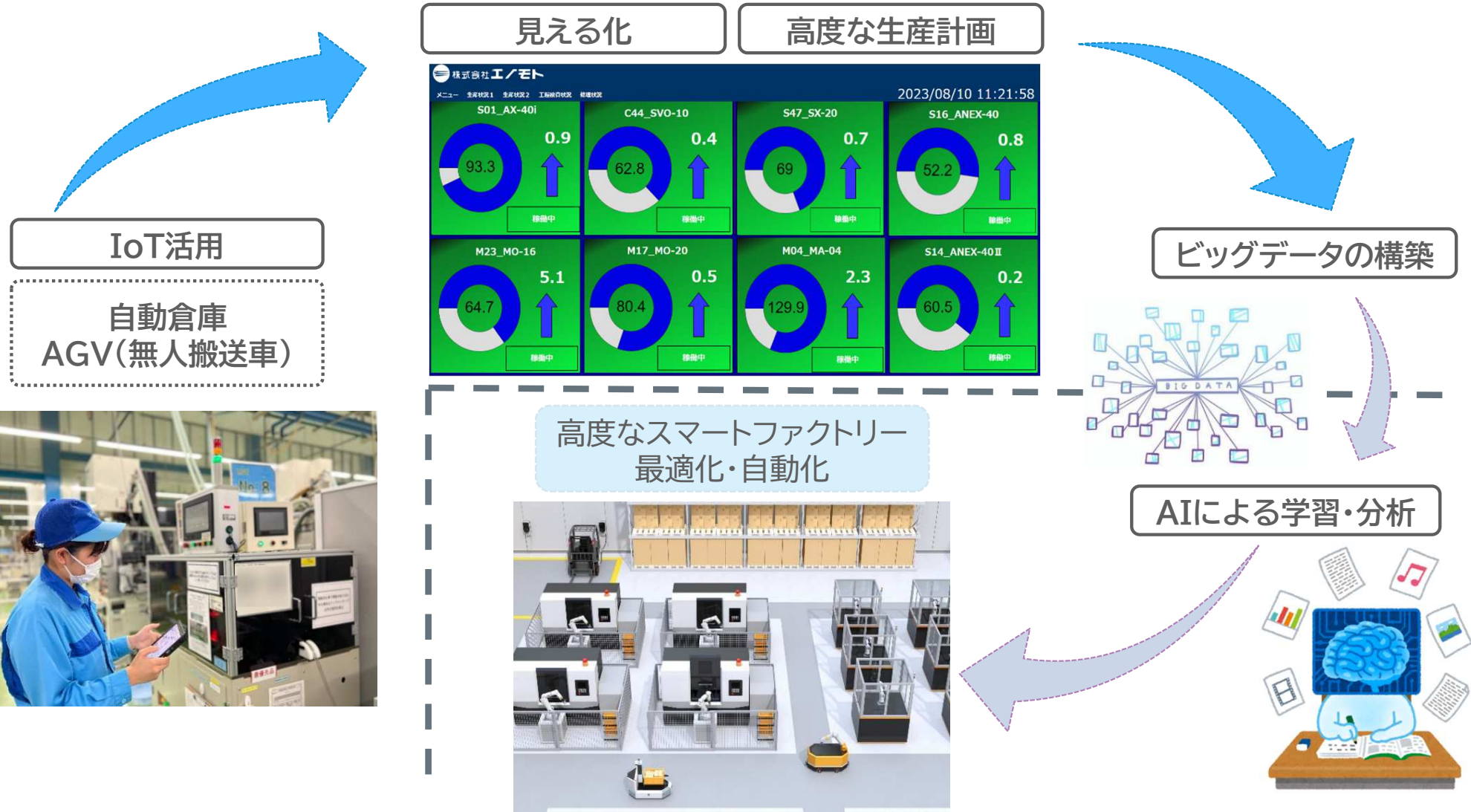
- 津軽工場で1ライン、中国新工場で4ラインのメッキラインを新設。  
2023年1-3月期から稼働、量産に向け認定待ち
- 表面処理プロジェクト室を新設し、メッキ組織を強化

中国新工場

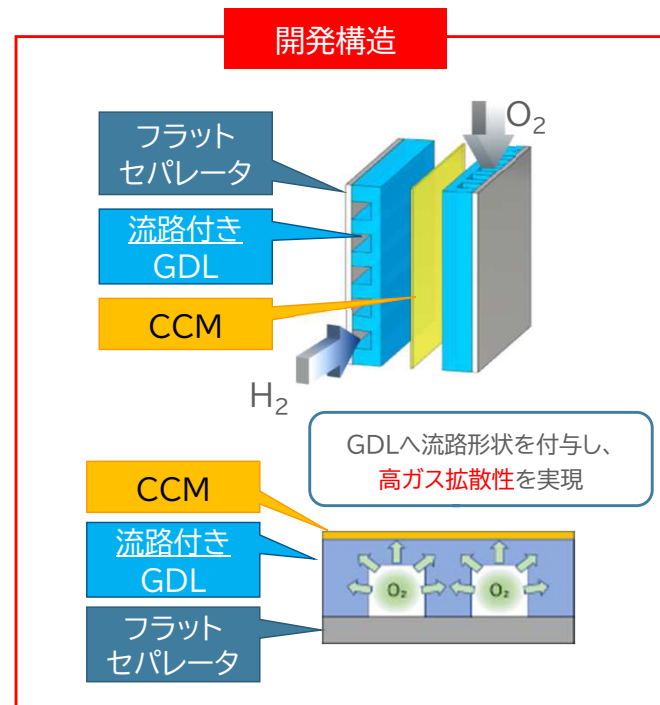
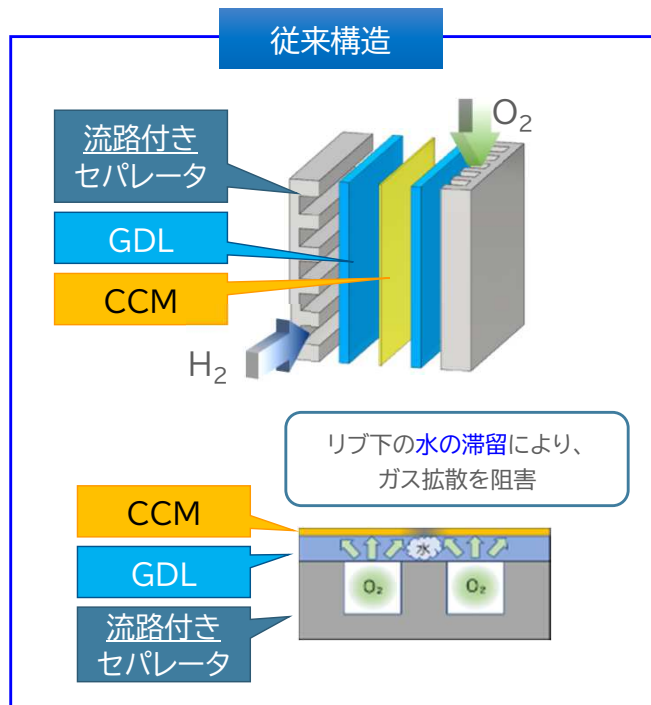




- スマートファクトリー実現に向けて、2022年4月に新ERPシステムへの切り替えを実施
- IoTデータとERP上のデータを活用し国内全工場の生産状況を見える化
- ビッグデータを構築し、AI活用した生産効率の向上や経営判断の迅速化につなげる



- 固体高分子形燃料電池(PEFC)向けガス拡散層(GDL)一体型金属セパレータを山梨大学と共同開発
- 新開発の流路付きGDL(GDLFC<sup>+</sup>)で大幅な高電流密度化を実現、当社技術により汎用樹脂にガス流路を成形
- 金属セパレータ、GDLを自社生産し、ガスケットと一体化し、コストを削減
- 2025年に燃料電池車向けのテスト開始、将来はFCV、ドローン、緊急電源、エネファーム等での実現を図る



## 2021年5月

日本で初めて制作された国産の燃料電池を電源とする電動アシスト自転車に当社製「ガス拡散層一体型セパレータ」が搭載

## 2021年7月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)共通課題解決型産学官連携研究開発事業に採択  
→採択期間は2025年3月まで更新

## 2022年11月

山梨大学及びスズキ株式会社と連名で寄稿した論文\*がアメリカ電気化学会(ECS)にオープンアクセス版として掲載

## 2023年8月

FCyFINEの水素燃料電池アシスト自転車の実証実験として、道の駅 富士川(山梨県南巨摩郡富士川町)にてレンタル自転車を5台導入。

## 2023年9月

山梨大学及びスズキ株式会社と連名で寄稿した論文\*\*が国際的な学術・技術専門誌「Journal of Power Sources」(ELSEVIER社)オープンアクセス版に掲載。

\* 「Improvement of PEFC Performance Stability under High and Low Humidification Conditions by Use of a Gas Diffusion Layer with Interdigitated Gas Flow Channels (対向櫛歯型流路が形成されたガス拡散層が固体高分子型燃料電池セルの高加湿および低加湿条件下における出力安定性の向上に及ぼす影響)」

<https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac9edf>

\*\* 「Analysis of performance stability under conditions of high & low humidity of polymer electrolyte fuel cells with interdigitated gas flow channels formed on a gas diffusion layer: An X-ray imaging and modeling study (対向櫛歯状ガス流路を形成させたGDLを有する固体高分子形燃料電池の高湿度・低湿度条件下での性能安定性の解析: X線イメージングとモデリングによる検討)」

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775323009990>

- ・メインターゲットはFCV－2030年FCV市場規模3兆9,011億円
- ・2023年3月時点において特許6件(国際:4件、国内:2件)出願中
- ・量産に向け2015年比約1/10コストへの削減を目指す

1st STEP(2021~2023)

2nd STEP(2024~2026)

3rd STEP(2027~2030)

FCV向け  
現行モデル

- ・顧客仕様、条件への適用開発
- ・量産ラインの稼働実験
- ・顧客開拓

- ・顧客仕様、条件への適用開発
- ・量産ライン準備
- ・顧客開拓

- ・量産開始
- ・2030年実用化へ

エネルギー  
その他

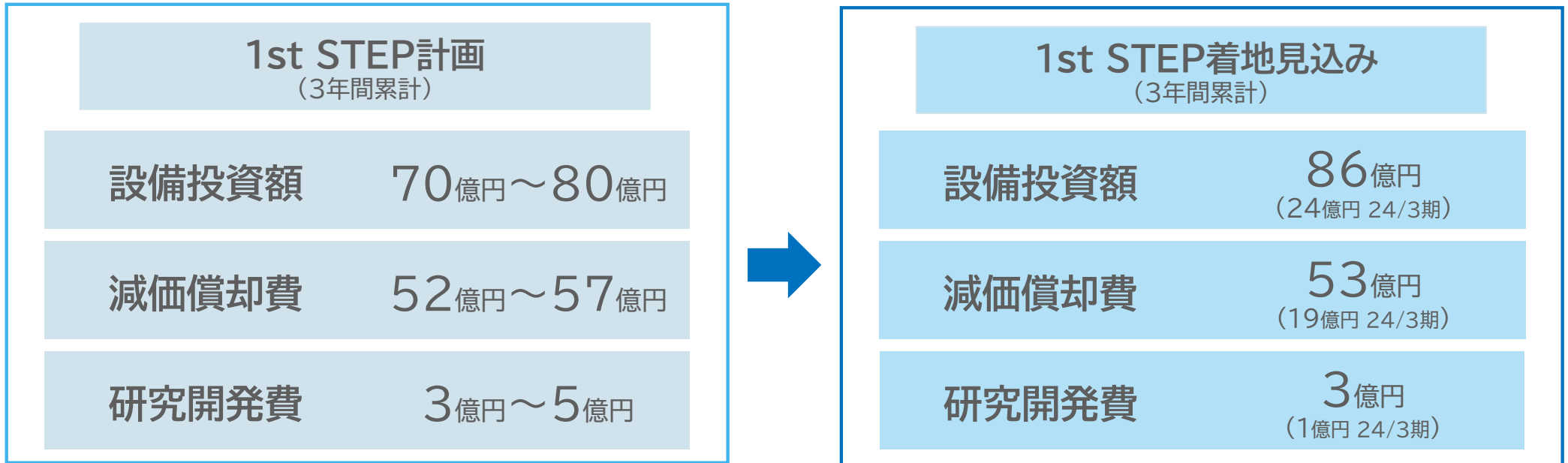
- ・顧客開拓
- ・顧客仕様、条件への適用開発
- ・量産ライン稼働→実用化へ

- ・FCV、ドローン、  
緊急電源、エネファーム等での実用化を図る

- ・改良型燃料電池の製造・研究開発・実用化による、水素社会の普及に貢献
- ・山梨県、山梨大学等と共に、産官学連携による燃料電池の研究開発の推進
- ・政府も本燃料電池の研究開発を支援、文科省に引き続きNEDOの研究開発事業に採択

(\*1)FCV市場規模 出所:富士経済・2021年版 燃料電池関連技術・市場の将来展望

- 津軽工場増設に加えて、リードフレームの増産等により、中計見直し後の設備投資計画70億円～80億円に対し86億円の計画だが、実施時期は資産効率を考慮し慎重に判断
- 3年間の減価償却費は、当初の52～57億円に対し53億円となる見込み
- 研究開発は計画通り進捗、3年間累計で3億円を計画



## 主要設備投資

- メッキ工程内製化投資 12億円
- 津軽工場増築 31億円 (スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタの増産)
- パワー半導体用リードフレームの増産 10億円
- スマートファクトリー化に向けたデジタル投資 5億円
- 再エネ・省エネ投資 9億円

- 2024年3月期は中長期的な成長に向けた仕込み期間と位置付け  
次期中期経営計画「2nd STEP」中に、2022年5月に上方修正した「1st STEP」の数値目標の達成を目指す
- 先行指標の金型受注は急増しており、足下の生産調整後の需要回復に大きな期待

## 1 パワー半導体用リードフレーム

- 拡大が予測されているパワー半導体市場に向けクリップボンディングリードフレームを拡販  
⇒ 中国に加え日本・フィリピンにおいても量産本格化

## 2 オプト用リードフレーム

- 車載/民生向け部品のハイエンドLED用リードフレーム受注増に対する、増産体制確立  
(津軽工場を活用予定)

## 3 コネクタ用部品

- 5G/6Gに向け、高周波対応のマイクロコネクタによる更なるシェアアップ
- 中長期的な成長が見込まれるウェアラブル市場へのマイクロコネクタ拡販

## 4 メッキライン(内製化)

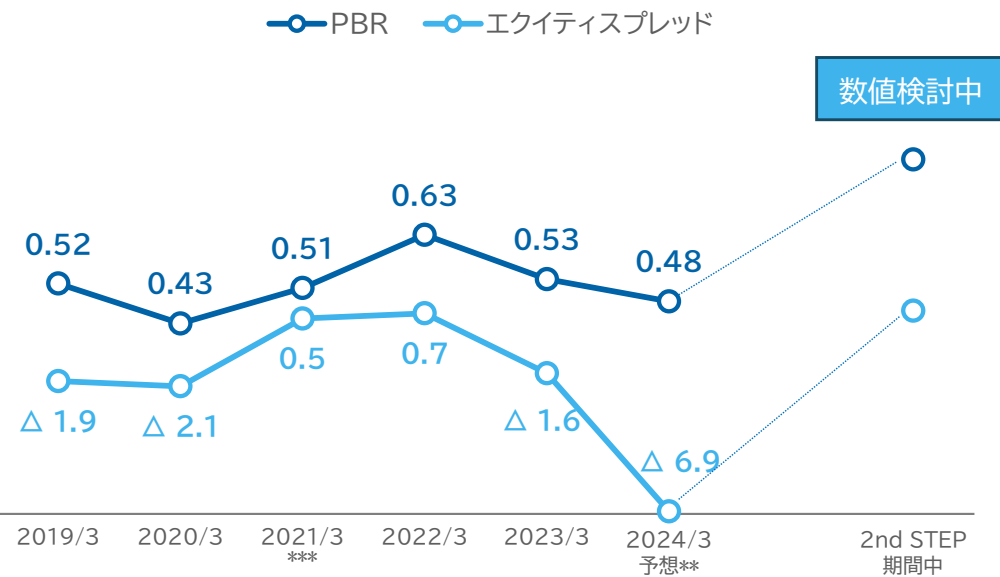
- 中国メッキ新工場、津軽工場新メッキラインの量産効果による付加価値率の更なる向上

## (6) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて

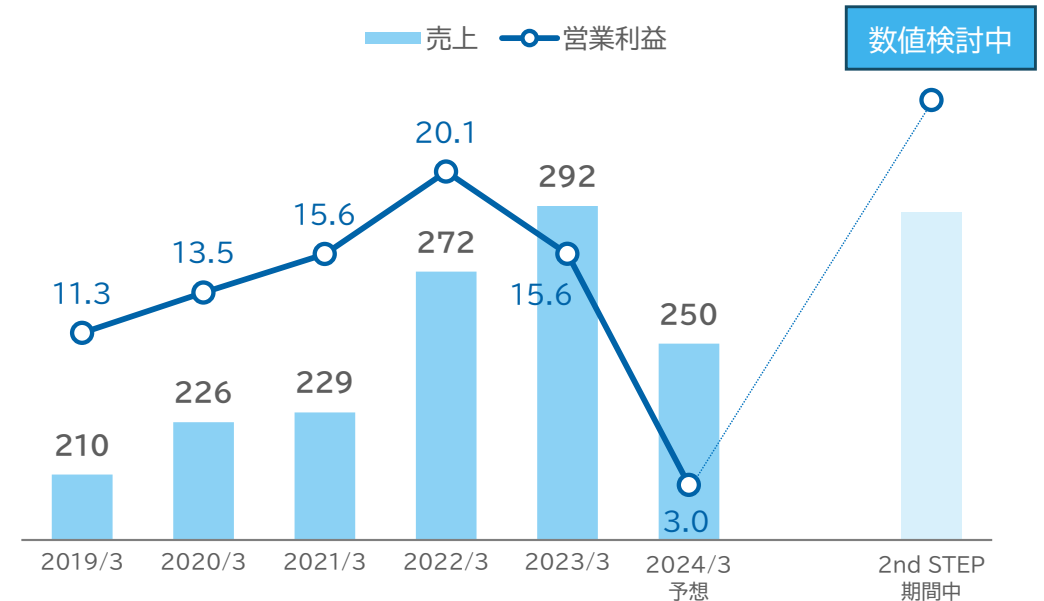


- 株主資本コストは7~8%と認識
- 配当政策DOE発表前のPBRはエクイティスプレッド\*と一定の相関性
- 1stステップにおけるROE目標9%を次期中期経営計画(2nd ステップ)期間中に目指すことを検討中  
エクイティスプレッドを拡大し、PBR向上を目指す

PBR・エクイティスプレッド (単位:%)



売上高・営業利益 (単位:億円)



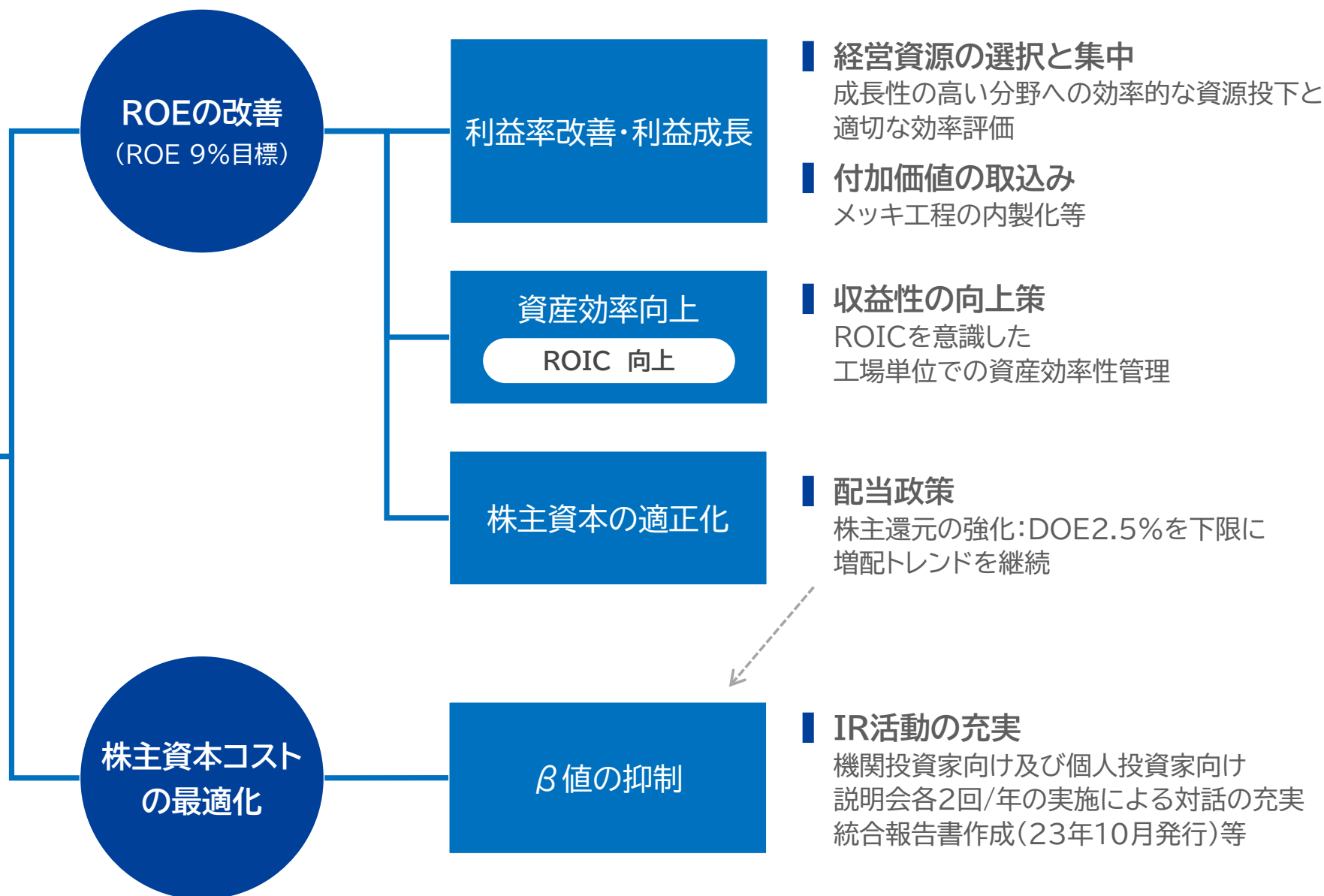
\*エクイティスプレッド=ROE-株主資本コスト(株主資本コストは8%で計算)

\*\* PBRは2024/3月期2Qの株主資本と10月末株価で算出  
足元においては配当政策を評価され、配当利回りが株価の下支えとなり  
大幅なマイナスのエクイティスプレッドをカバーしていると推定

\*\*\* 2021/3月期  
繰延税金資産の計上による一時的なROE上昇分を控除

現在、次期中期経営計画を策定中しており、2024年3月期決算発表時に公表予定

## 企業価値 最大化





## (7) 中期環境計画の進捗(SDGsへの取組み)



- 単体での中期環境計画に加えて、2023年4月にはグループベースでの中期環境計画を作成

当社グループ全体

2030年度 目標

**GHG排出総量 11,080 t-CO<sub>2</sub>**

**GHG排出削減量 6,732 t-CO<sub>2</sub>** (2021年度比)   
 { 再エネ活用 4,488 t-CO<sub>2</sub>  
 省エネ対策 2,244 t-CO<sub>2</sub>

## アクションプラン

1

### 再エネ活用

- 太陽光発電設備の設置
- カーボンフリー電力の購入
- EV車両の導入

**GHG排出削減量 4,488 t-CO<sub>2</sub>**  
2021年度比 **25% 削減**

化石燃料による  
電力購入削減量 **約8,160,000 kwh**

2

### 省エネ対策

コンプレッサー

空調設備

照明機器

その他、生産設備

**GHG排出削減量 2,244 t-CO<sub>2</sub>**  
2021年度比 **13% 削減**

電力使用削減量 **約4,080,000 kwh**

## 太陽光発電設備の設置

2023年度完成予定

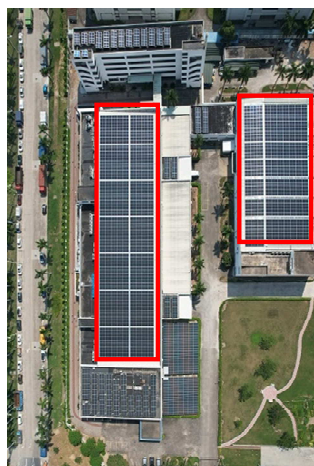
◆本社(塩山)技術棟



発電容量 : 約215kW

2024年2月稼働開始予定

◆中山益能達精密電子有限公司



発電容量: 630kW

2023年7月稼働開始

### 参考情報

本社(塩山)



本社(上野原)



本社(塩山屋根)



津軽



2023年4月 稼働開始

フィリピン

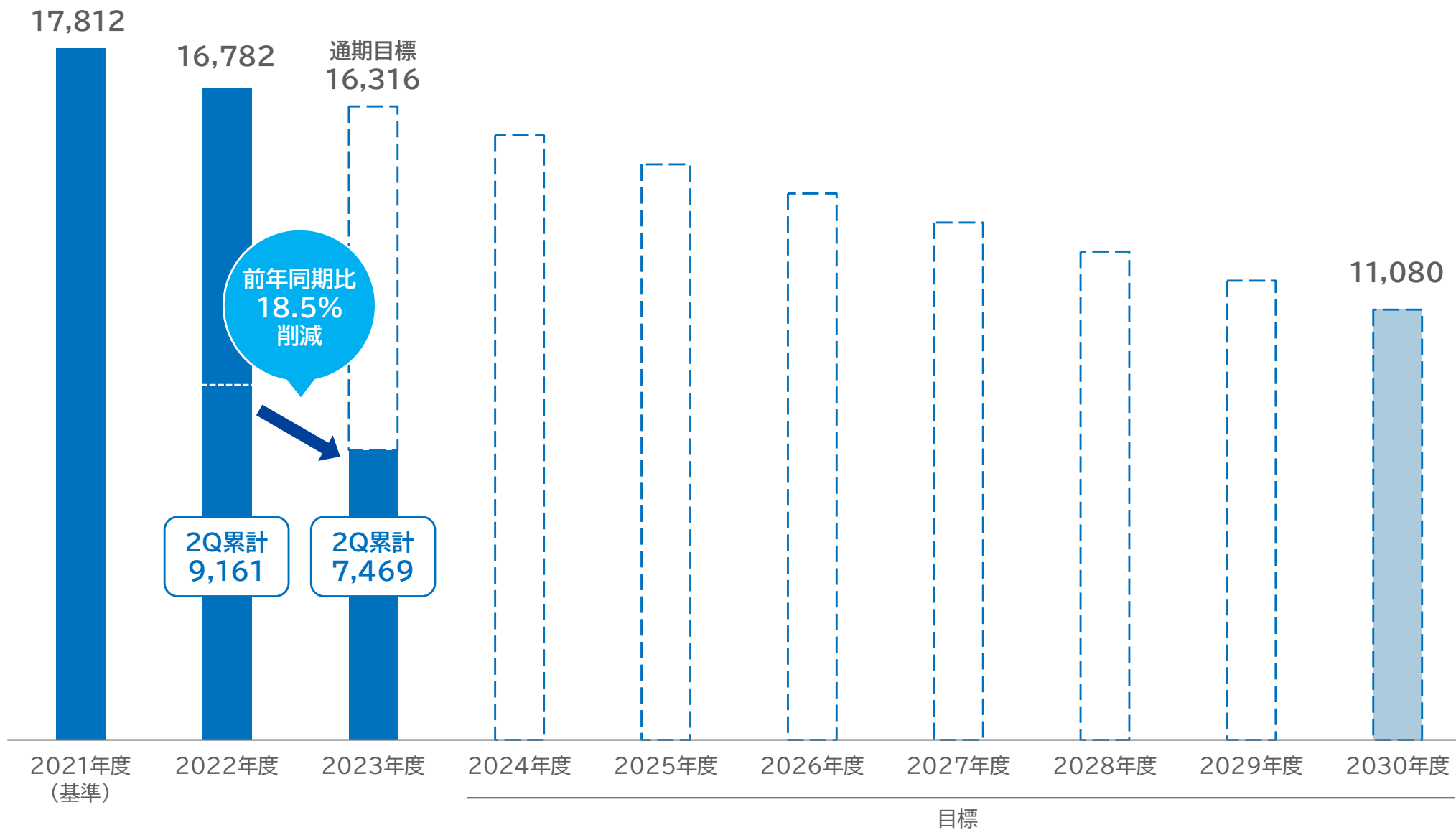


中国



左記完成後の今期末発電容量: 約4MW

## GHG排出量(t-CO<sub>2</sub>)



# Appendix



- ・ 利益減により営業キャッシュフローは前年同期比減少したもののプラスを維持
- ・ 津軽工場増築など大型の設備投資一巡により、フリーキャッシュフローは約1.7億円のプラス、前同比でも改善

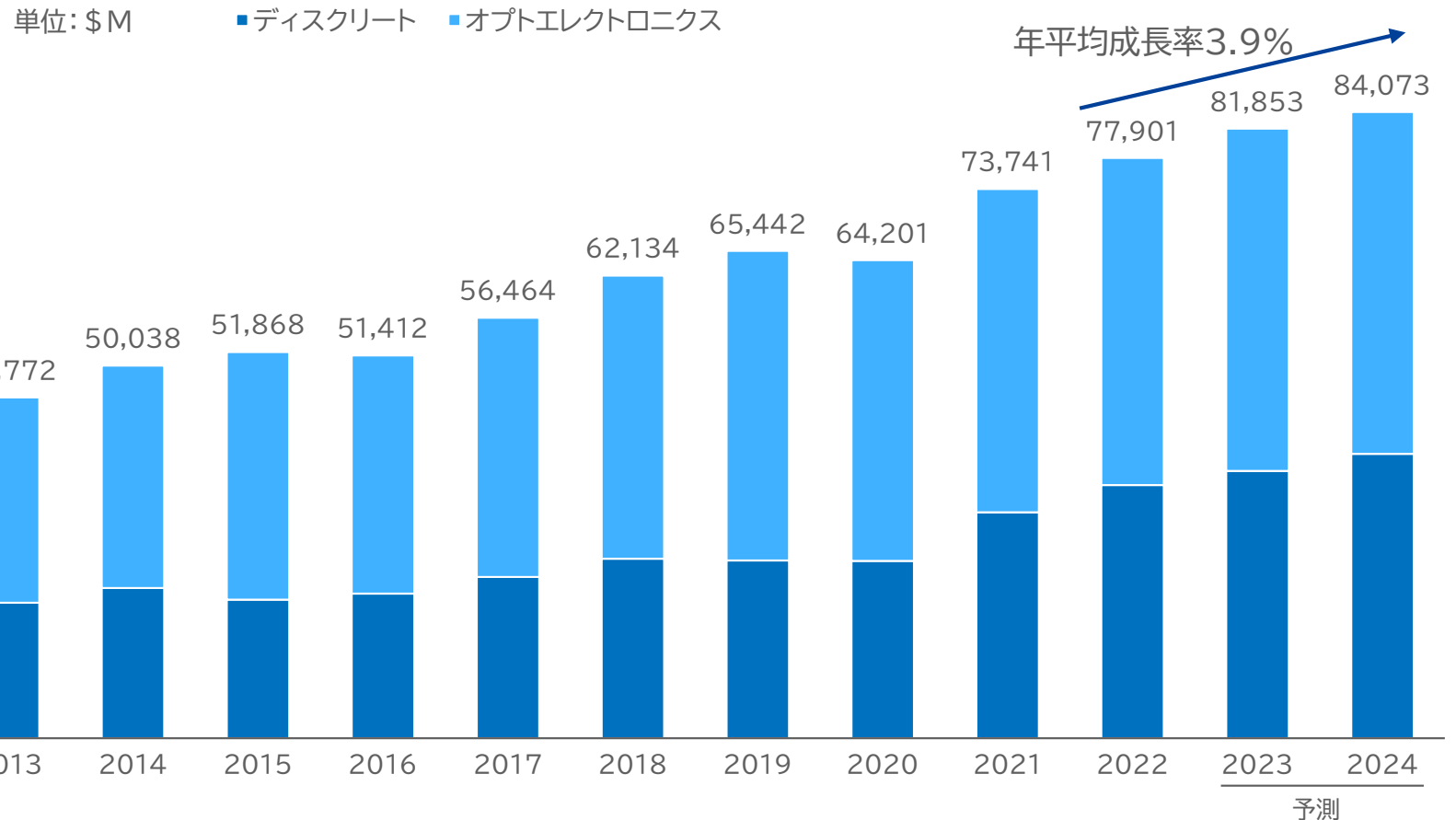
単位:百万円	2023/3期2Q累計	2024/3期2Q累計	前期比増減
営業活動によるキャッシュフロー	1,137	897	△239
税金等調整前当期純利益	1,123	183	△939
減価償却費	850	968	+117
棚卸資産の増加	△538	578	+1,116
投資活動によるキャッシュフロー	△1,233	△721	+511
有形固定資産の取得による支出	△1,203	△764	+439
財務活動によるキャッシュフロー	△255	△234	+20
長期借入れによる収入	0	0	0
長期借入金の返済による支出	△133	△199	△66
配当金の支払い額	△204	△204	+0
現金及び現金同等物の期末残高	4,498	4,176	△321
フリーキャッシュフロー	△95	176	+271

- 2023年3月期はコネクタ用部品で津軽工場・中国子会社でのメッキ工程の生産設備を導入、パワー半導体用リードフレームは2nd STEPで計画していた中国子会社などへの増産投資を前倒しで実施
- 2024年3月期は海外工場のメッキ設備やコネクタ関係の金型投資を中心に24.8億円の設備投資を計画

単位:百万円	2022/3期	2023/3期	2024/3期予想	前期比増減
設備投資	3,127	2,979	2,486	△493
パワー半導体用 リードフレーム	330	897	719	△178
オプト用 リードフレーム	111	307	130	△177
コネクタ用部品	2,384	1,136	1,258	+122
その他	301	637	377	△260
減価償却費	1,664	1,717	1,897	+180

- ・ ディスクリート市場は、パワー半導体等が車載やデータセンター、5G基地局向けなどにより中期的にも大きく成長
- ・ オプトエレクトロニクス市場は、車載向けの搭載率上昇や、デジタルサイネージ・大型ディスプレイの需要回復などから堅調に推移

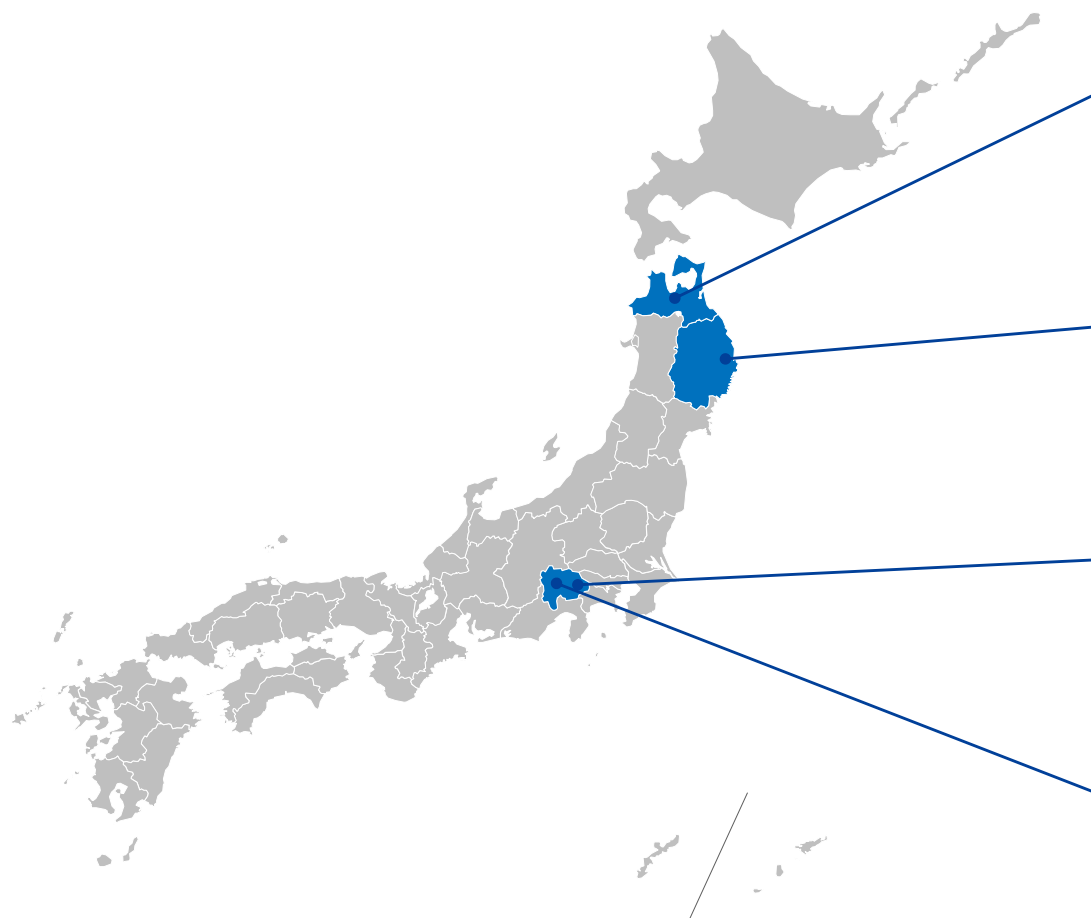
世界のディスクリート半導体とオプトエレクトロニクス市場予測



出所: WSTS「世界半導体市場統計」



- スマートフォンやウェアラブル端末の需要増加に対応するため、津軽工場を増築し、マイクロコネクタの生産能力を増強、5年間の投資額は31億円を計画
- リードフレームはパワー半導体向けなど高電圧・高電流対応品の生産体制を強化



## 津軽工場

主要生産品目

スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタ



## 岩手工場

主要生産品目

車載向け受動部品

スマートフォン向けコネクタ



## 本社工場(上野原)

主要生産品目

オプト用リードフレーム

リレー部品



## 本社工場(塩山)

主要生産品目

パワー半導体用リードフレーム

オプト用リードフレーム

- 中山工場(中国)では、リードフレームやコネクタ用部品を、金型製作から組み立てまで一貫生産、パワー半導体向けのクリップボンディングリードフレームを量産
- フィリピン工場では、車載向けのコネクタ用部品などを、金型製作から樹脂成形まで一貫生産、主に日系の東南アジア拠点向けに販売

## 中国



営業拠点 **ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd**  
生産拠点 **ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.**  
主要生産品目 パワー半導体用リードフレーム  
スマートフォン向けコネクタ用部品

## フィリピン

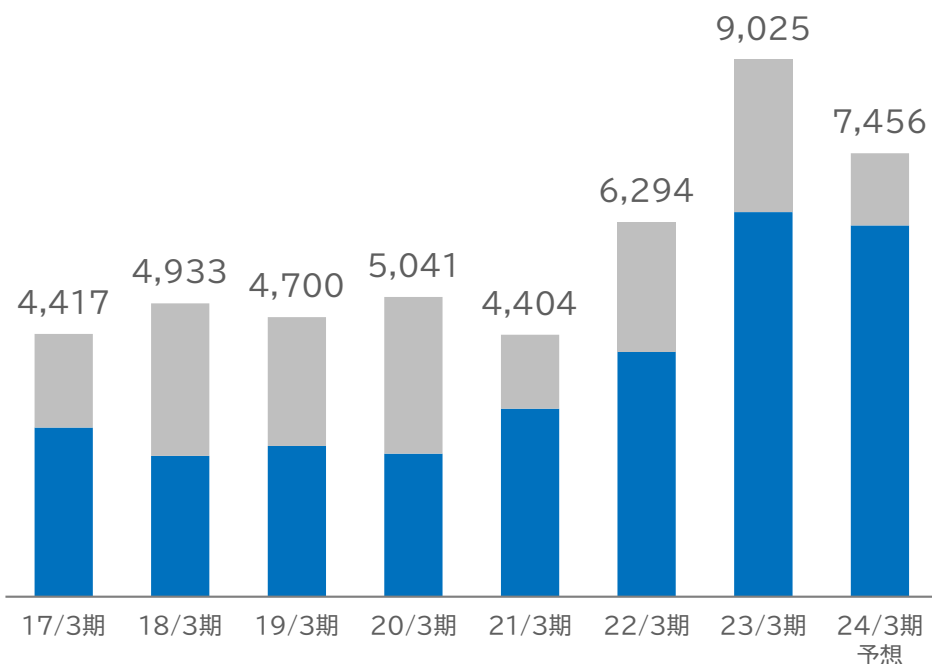


生産拠点 **ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.**  
主要生産品目 エアバッグ向け大型コネクタ用部品  
車載向けスイッチ部品  
パワー半導体用リードフレーム

- 日系機器メーカーの工場移転や海外企業の台頭に対応し、中国・フィリピンでも金型から一貫生産
- 中国工場ではクリップボンディングリードフレームを国内メーカーに先駆けて大量生産、日本企業と同タイプ製品への本格参入にあたり、当社グループは量産実績を背景に受注で優位に
- フィリピン工場では車載向け部品が成長

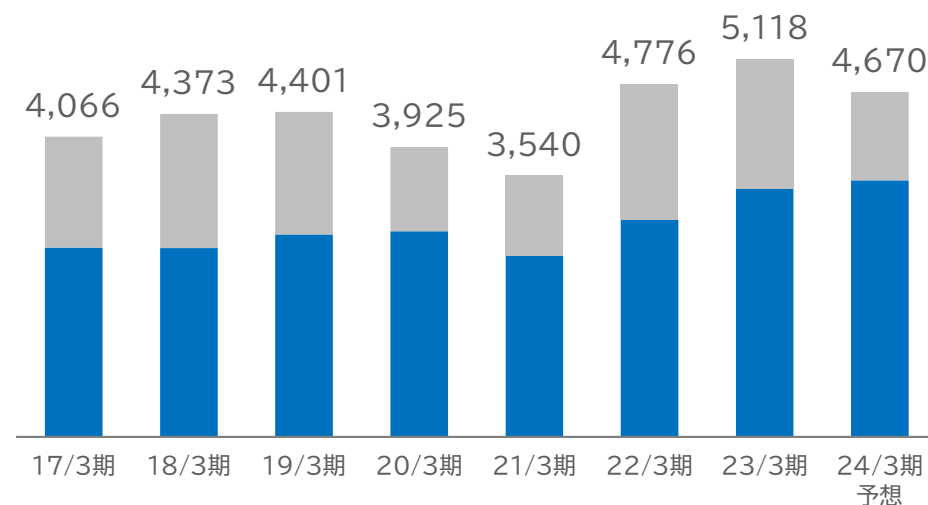
### 中国子会社の売上高推移

■内、パワー半導体用リードフレーム(百万円)

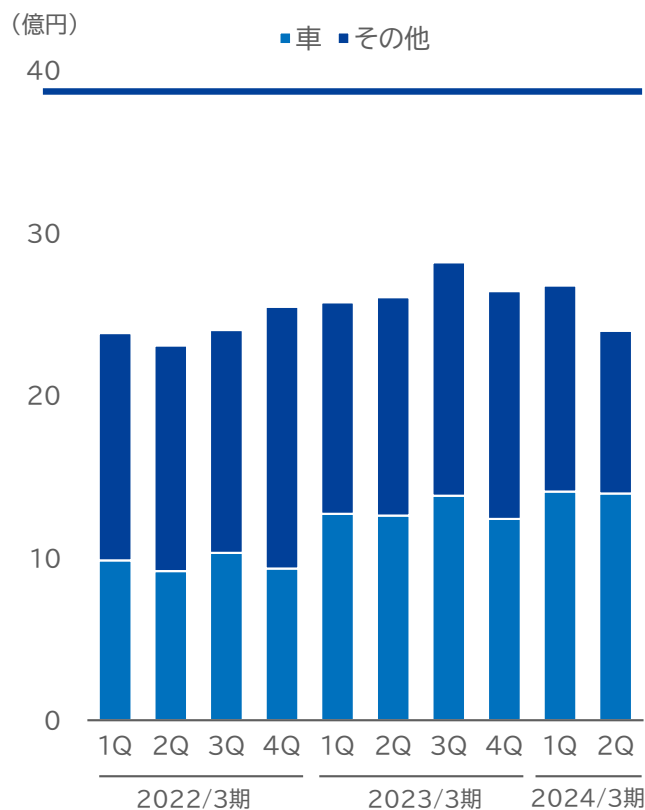


### フィリピン子会社の売上高推移

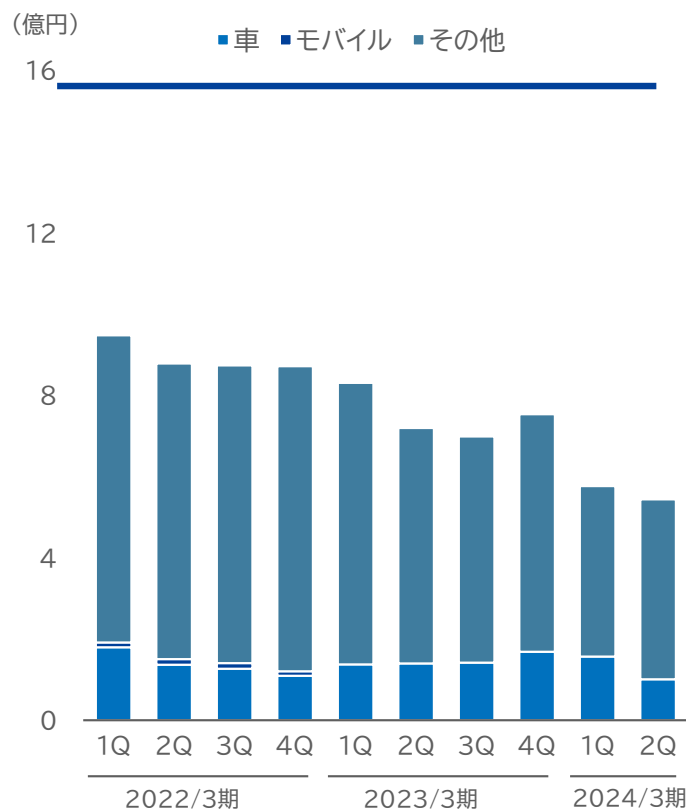
■内、車載向け部品(百万円)



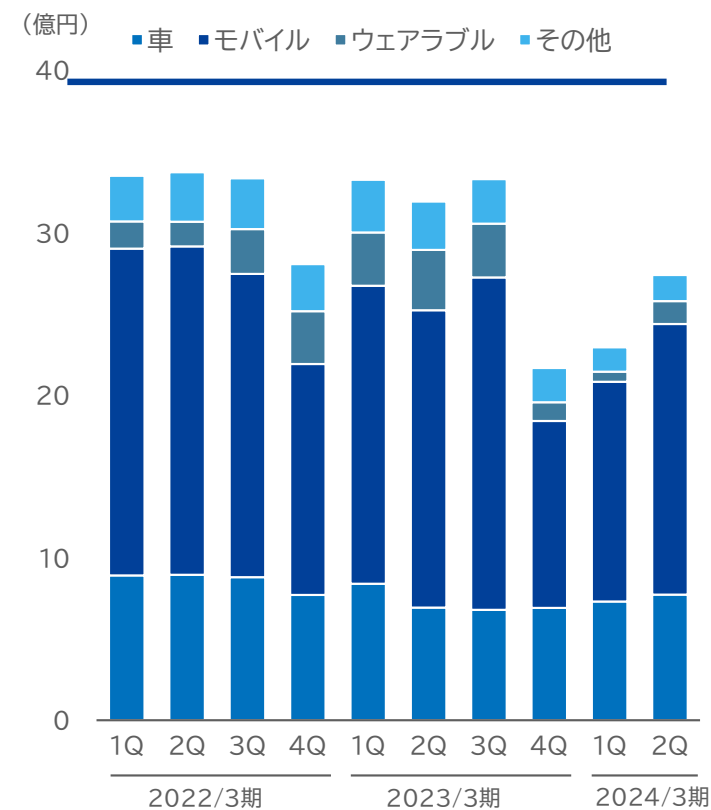
## パワー半導体用リードフレーム



## オプト用リードフレーム




## コネクタ用部品



注:用途別量産品売上高は為替レートを固定した売上高で算出しており、製品群別売上高の数値とは一致しない

- SDGsへの取り組みとして以下を策定し、順調に進捗
- 2022年5月には中期環境計画を定め、2030年のGHG排出削減量を定めて、取り組みを強化
- 2023年5月には海外工場等も含む連結での中期環境計画を策定

重点分野	関連するSDGs	現在の取り組み	1st STEPでの対応策
脱炭素社会の実現	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 産官学連携による燃料電池部品開発</li> <li>• 太陽光パネルの設置</li> <li>• 照明の完全LED化推進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 燃料電池部品の量産ライン稼働実験</li> <li>• 太陽光パネルの増設(津軽工場に設置)</li> <li>• 二酸化炭素排出量の測定と開示法の策定</li> </ul>
誰もが活躍できる社会の実現	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 子育てのしやすい環境の整備(プラチナくるみん*)</li> <li>• 在宅勤務制度の実施</li> <li>• 健康優良企業「銀の認定」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度活用促進によるプラチナくるみんの継続</li> <li>• 多様性を重視した管理職育成</li> <li>• 障がい者・外国籍雇用体制の更なる拡充</li> <li>• 健康優良企業「銀の認定」更新</li> </ul>
みんなが幸せになれる社会の実現	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• フードバンク活動</li> <li>• 学習支援活動への協賛</li> <li>• 地域活動、スポーツ団体への協賛</li> <li>• ボランティア休暇制度実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 採用活動や経済活動を通じた地域との共生</li> <li>• リサイクル活動強化</li> </ul>

\*プラチナくるみん : 次世代育成支援対策促進法に基づき、仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる企業を認定

## 注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。